



ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียนhardtดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล

**An Optimal Fly-Height Control Algorithm for Soft Error Rate Reduction During  
Read-Write Process**

ธัญญพร ชาญณรงค์

Tanyaporn Channarong

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of  
**Master of Engineering in Electrical Engineering**  
**Prince of Songkla University**

2553

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(1)

**ชื่อวิทยานิพนธ์** ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียน Harvard เพื่อลดข้อผิดพลาด  
จากการอ่าน-เขียนข้อมูล  
**ผู้เขียน** นายชัญณพ ชาญณรงค์  
**สาขาวิชา** วิศวกรรมไฟฟ้า

| อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   | คณะกรรมการสอน  |
|---|--|
| .....<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐร้า จินดาเพ็ชร์)   | .....<br>ประธานกรรมการ<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิกร สมิต ไมตรี) |
| อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม   | .....<br>กรรมการ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู)              |
| .....<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู)  | .....<br>กรรมการ<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศศักดิ์ เลขวัต)           |
| .....<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐร้า จินดาเพ็ชร์)   | .....<br>กรรมการ   |
| บันทึกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | .....<br>(รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู)<br>คณบดีบันทึกวิทยาลัย  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ชื่อวิทยานิพนธ์</b> | ระเบียบวิธีสำหรับความคุณระยะหัวอ่าน-เขียนสาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล |
| <b>ผู้เขียน</b>        | นายธัญญพร ชาญณรงค์   |
| <b>สาขาวิชา</b>        | วิศวกรรมไฟฟ้า  |
| <b>ปีการศึกษา</b>      | 2552   |

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เสนอการออกแบบระเบียบวิธีสำหรับความคุณระยะหัวอ่าน-เขียนสาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูลโดยศึกษาผลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระยะการบินของหัวอ่าน-เขียนสาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยดูความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหัวอ่าน-เขียนสาร์ดดิสก์เข้าใกล้ดิสก์ ซึ่งมีตัวแปรที่ทดสอบคือ position error signal (PES) เป็นตัวระบุตำแหน่งหัวอ่าน-เขียนสาร์ดดิสก์ และ digital to analog converter (DAC) ที่ป้อนให้แก่ voice coil motor เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวอ่าน-เขียน ผลการศึกษาพบว่าค่า DAC เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้ดิสก์ จึงใช้ค่า DAC ในกระบวนการตรวจสอบระยะหัวอ่าน-เขียนข้อมูล ได้คืนเฉลี่ย 6.99% เมื่อเปรียบเทียบค่าระยะการบินที่ถูกกำหนดจากโรงงาน

**คำสำคัญ**      ระยะการบินของหัวอ่าน-เขียนสาร์ดดิสก์ ข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Thesis Title</b>  | An Optimal Fly-Height Control Algorithm for Soft Error Rate Reduction During Read-Write Process |
| <b>Author</b>        | Mr.Tanyaporn Channarong   |
| <b>Major Program</b> | Electrical Engineering  |
| <b>Academic Year</b> | 2009  |

## **ABSTRACT**

This thesis presents an optimal fly-height (FH) control algorithm for soft error rate (SER) reduction during read-write processes. The studied parameters in this algorithm are the position error signal (PES) and the voice coil motor digital to analog converter (DAC) values. The study results show that the DAC values change noticeably when the head moves close to the disk. Therefore, the DAC values are used to indicate when the head moves close to the disk and specify FH to reduce SER. The result of the proposed algorithm can improve FH to reduce SER better than the FH set from factory. The SER can be improved 6.99% at average.

Keywords: fly-height (FH), soft error rate (SER)

## กิตติกรรมประกาศ

ขอแสดงคำขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัทร จินดาเพ็ชร์ ประธานกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนการทำวิจัย กรุณาอุทิศเวลาให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ในด้านการทำวิจัย เอกสาร ข้อมูลต่างๆเป็นอย่างดี รวมทั้งแนวความคิดและกำลังใจ ในการแก้ปัญหาตลอดจนตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกริกชัย ทองหนู กรรมการที่ปรึกษา งานวิจัยที่ได้กรุณาอุทิศเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในงานวิจัย ตลอดจนช่วยตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิกร สมิตไนครี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในงานวิจัย ให้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เดิศศักดิ์ เลขวัต อาจารย์กรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประযุชน์ต่องานวิจัย

ขอขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่กรุณาให้ทุนการศึกษาแก่ข้าพเจ้าระหว่างการศึกษา

ขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบสารคดิสก์ไดร์ฟคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนในการทำงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ บริษัทอิตาชิ โกลบลอด สตอเรจ เทคโนโลยีส์ ประเทศไทย จำกัด ที่กรุณาให้ข้อมูลสนับสนุนในการทำงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆมาโดยตลอด จนกระทั้งงานสำเร็จลุล่วง

ขอขอบพระคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการประสานงานต่าง ๆ

ขอขอบคุณ พี่ๆ และเพื่อนๆ รวมทั้งน้องๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของบิความราคและครอบครัว ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ และทุนทรัพย์แก่ข้าพเจ้าตลอดมาจนกระทั้งทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ

ธัญญพร ชาญณรงค์

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| สารบัญ   | 6)   |
| รายการตาราง  | (9)  |
| รายการภาพประกอบ  | (10) |
| บทที่  |      |
| 1. บทนำ.....   | 1    |
| 1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย.....                        | 1    |
| 1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....                         | 2    |
| 1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....                              | 6    |
| 1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....                                   | 6    |
| 2. ทฤษฎีและหลักการ.....                                      | 7    |
| 2.1 ความเป็นมาของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.....                        | 7    |
| 2.2 เทคโนโลยีหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.....               | 8    |
| 2.2.1 หัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ.....                      | 8    |
| 2.2.2 กระบวนการอ่าน-เขียนข้อมูล.....                         | 9    |
| 2.2.3 เทคโนโลยีของ MR และ GMR .....                          | 9    |
| 2.2.4 โครงสร้างเบื้องต้นของ MR head .....                    | 10   |
| 2.2.5 โครงสร้างเบื้องต้นของ GMR head .....                   | 11   |
| 2.2.6 การเขียนข้อมูลแบบ longitudinal และ perpendicular ..... | 13   |
| 2.2.7 การเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีของ perpendicular .....      | 13   |
| 2.2.8 เทคโนโลยีของ perpendicular recording .....             | 14   |
| 2.2.9 เทคโนโลยีของ tunnel magneto resistance (TMR).....      | 15   |
| 2.3 เทคโนโลยีการกำหนดระยะ FH.....                            | 16   |
| 2.3.1 เทคโนโลยี thermal fly-height control (TFC).....        | 16   |
| 2.3.2 Touch down power (TDP).....                            | 17   |
| 2.4 การระบุประสิทธิภาพ/ตำแหน่งของหัวฮาร์ดดิสก์.....          | 18   |
| 2.4.1 Soft error rate (SER).....                             | 18   |
| 2.4.2 Position error signal (PES).....                       | 18   |

## สารบัญ(ต่อ)

|   | หน้า |
|---|------|
| 2.4.3 การควบคุมตำแหน่งหัวอ่าน-เขียนให้อยู่กึ่งกลางแทร็ค.....  | 21   |
| 3. การจำลองการทำงานและทดสอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหัวอ่าน-เขียน.....   | 22   |
| 3.1 การจำลองการทำงานการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียน.....  | 22   |
| 3.1.1 วิธีการทดสอบ.....   | 22   |
| 3.1.2 ผลการจำลองการทำงาน.....   | 23   |
| 3.2. การทดสอบความสัมพันธ์ PES และ DAC.....  | 24   |
| 3.3 ภาพรวมของระบบที่ใช้ในการทดสอบ.....  | 24   |
| 3.4 การทดสอบระยะ FH ของหาร์ดดิสก์.....  | 25   |
| 3.4.1 วิธีการทดสอบ .....  | 25   |
| 3.4.2 ผลการทดสอบ FH.....  | 26   |
| 3.5 การทดสอบ PES และ DAC.....   | 30   |
| 3.5.1 วิธีการทดสอบ.....   | 30   |
| 3.5.2 ผลการทดสอบ PES.....   | 31   |
| 3.5.3 ผลการทดสอบ DAC.....   | 34   |
| 3.6 การทดสอบ SER.....   | 37   |
| 3.6.1 วิธีการทดสอบ.....   | 37   |
| 3.6.2 ผลการทดสอบ SER.....   | 38   |
| 4. การออกแบบระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียน harddisk เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล.....      | 42   |
| 4.1 ความเกี่ยวเนื่องของตัวแปรภายใน harddisk ไดร์ฟ.....  | 42   |
| 4.2 ข้อพิจารณาการเลือกใช้พารามิเตอร์.....   | 43   |
| 4.3 ข้อพิจารณาการตรวจจับความผิดปกติของค่า DAC.....  | 43   |
| 4.4 การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ย.....  | 44   |
| 4.5 การคำนวณเส้นตรวจจับความผิดปกติ.....   | 44   |
| 4.6 เทคนิคการแยกค่า DAC เพื่อใช้คำนวณ.....  | 45   |
| 4.7 สรุปการออกแบบระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียน harddisk เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล..... | 46   |

## สารบัญ(ต่อ)

|   | หน้า |
|---|------|
| 4.8 การทดสอบอัลกอริทึมกับชาร์ดดิสก์ไดร์ฟจริง..... | 48   |
| 4.9 การวิจารณ์ผลการทดสอบ.....                     | 49   |
| 5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....               | 50   |
| 5.1 สรุปผล.....                                   | 50   |
| 5.2 ปัญหา.....                                    | 51   |
| 5.3 ข้อเสนอแนะ.....                               | 51   |
| บรรณานุกรม.....                                   | 52   |
| ภาคผนวก.....                                      | 54   |
| ภาคผนวก ก.....                                    | 55   |
| ประวัติผู้เขียน.....                              | 64   |

## รายการตาราง

| ตาราง   | หน้า |
|---|------|
| 4-1 สรุปค่า SER และ FH ของ H0 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากโรงงาน.....      | 48   |
| 4-2 สรุปค่า SER และ FH ของ H0 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากอัลกอริทึม.....  | 48   |
| 4-3 สรุปค่า SER และ FH ของ H3 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากโรงงาน.....      | 48   |
| 4-4 สรุปค่า SER และ FH ของ H3 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากอัลกอริทึม.....  | 49   |
| 4-5 สรุปค่า SER และ FH ของ H0 ที่ได้จากการทดสอบของโรงงานกับอัลกอริทึม | 49   |
| 4-6 สรุปค่า SER และ FH ของ H3 ที่ได้จากการทดสอบของโรงงานกับอัลกอริทึม | 49   |

## รายการภาพประกอบ

| ภาพประกอบ  | หน้า |
|--|------|
| 1-1 ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์.....   | 2    |
| 1-2 โครงสร้าง Slider ABS 5 (a) Panda 3, (b) Design A.....                | 3    |
| 1-3 ตำแหน่งการบินของโครงสร้าง Slider ABS (a) Panda 3, (b) Design A ..... | 3    |
| 1-4 หมายเลข 104 ตำแหน่งหัวฮาร์ดดิสก์และหมายเลข 100 ดิสก์.....            | 5    |
| 1-5 ภาพตัดขวางเฉพาะบริเวณหัวอ่าน-เขียนเมื่อไม่ให้ความร้อน.....           | 5    |
| 1-6 ภาพตัดขวางเฉพาะบริเวณหัวอ่าน-เขียนเมื่อให้ความร้อน .....             | 5    |
| 1-7 ลักษณะสัญญาณ PES ของไคร์ฟปกติ.....                                   | 6    |
| 1-8 ลักษณะสัญญาณ PES ของไคร์ฟไม่ปกติ.....                                | 6    |
| 2-1 อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีของ magnetic head ของ HDD.....             | 8    |
| 2-2 โครงสร้างของ MR และ GMR.....   | 8    |
| 2-3 กระบวนการอ่าน-เขียนข้อมูล.....                                       | 9    |
| 2-4 การเปลี่ยนแปลงความต้านทานของ sensing layer MR และ GMR.....           | 10   |
| 2-5 โครงสร้างเบื้องต้นของ MR head.....                                   | 10   |
| 2-6 โครงสร้างเบื้องต้นของ GMR head.....                                  | 11   |
| 2-7 การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนของ GMR sensor.....                        | 12   |
| 2-8 ผลตอบสนองของสนามแม่เหล็กต่อความต้านทานของ GMR.....                   | 12   |
| 2-9 การเขียนข้อมูลแบบ longitudinal.....                                  | 13   |
| 2-10 การเขียนข้อมูลแบบ perpendicular.....                                | 13   |
| 2-11 โครงสร้างหัวอ่าน-เขียนของเทคโนโลยี perpendicular.....               | 14   |
| 2-12 โครงสร้างของ soft magnetic under layer.....                         | 14   |
| 2-13 โครงสร้าง tunnel magneto resistance layer.....                      | 15   |
| 2-14 แนวโน้มเทคโนโลยีหัวอ่าน-เขียน.....                                  | 16   |
| 2-15 หัวอ่าน-เขียนก่อนให้ความร้อน.....                                   | 17   |
| 2-16 หัวอ่าน-เขียนหลังให้ความร้อน.....                                   | 17   |
| 2-17 โครงสร้างของ track.....   | 19   |
| 2-18 รูปแบบของ burst pattern .....                                       | 19   |
| 2-19 สัญญาณที่ตำแหน่ง 0.....   | 19   |

## รายการภาพประกอบ

| <b>ภาพประกอบ</b>   | <b>หน้า</b> |
|--|-------------|
| 2-20 สัญญาณที่ตำแหน่ง 1.....   | 20          |
| 2-21 สัญญาณ PES in-phase และ quadrature.....                                 | 20          |
| 2-22 การทำงานงานของ head position loop control .....                         | 21          |
| 3-1 โครงสร้าง slider.....  | 23          |
| 3-2 การยื่นตัวของหัวอ่านเขียน.....   | 23          |
| 3-3 ภาพรวมของระบบที่ใช้ทดสอบ.....  | 24          |
| 3-4 เริ่มให้ความร้อนที่หัวอ่าน-เขียน.....                                    | 25          |
| 3-5 หัวอ่าน-เขียนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น.....        | 25          |
| 3-6 กำลังงานที่ทำให้หัวอ่าน-เขียนสัมผัสดีสก์.....                            | 26          |
| 3-7 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H0 สัมผัสดีสก์.....    | 26          |
| 3-8 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H1 สัมผัสดีสก์.....    | 27          |
| 3-9 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H2 สัมผัสดีสก์.....    | 27          |
| 3-10 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H3 สัมผัสดีสก์.....   | 27          |
| 3-11 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H0 สัมผัสดีสก์.....   | 28          |
| 3-12 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H1 สัมผัสดีสก์.....   | 28          |
| 3-13 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H2 สัมผัสดีสก์.....   | 28          |
| 3-14 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H3 สัมผัสดีสก์.....   | 29          |
| 3-15 ระบบที่ทดสอบ PES และ DAC.....   | 30          |
| 3-16 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 31          |
| 3-17 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 31          |
| 3-18 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 32          |
| 3-19 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 32          |
| 3-20 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 32          |
| 3-21 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 33          |
| 3-22 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 33          |
| 3-23 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน.. | 33          |
| 3-24 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน   | 34          |

## รายการภาพประกอบ

| ภาพประกอบ   | หน้า |
|---|------|
| 3-25 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 34   |
| 3-26 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 35   |
| 3-27 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 35   |
| 3-28 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 35   |
| 3-29 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 36   |
| 3-30 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 36   |
| 3-31 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน      | 36   |
| 3-32 การลดระยะ FH ด้วยการลดกำลังงานที่ให้แก่หัวอ่าน-เขียน.....                  | 38   |
| 3-33 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H0.....  | 38   |
| 3-34 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H1.....  | 39   |
| 3-35 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H2.....  | 39   |
| 3-36 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H3.....  | 39   |
| 3-37 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ Zone0.....   | 40   |
| 3-38 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ Zone12.....  | 40   |
| 3-39 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ Zone23.....  | 40   |
| 4-1 ตัวอย่างค่า DAC ของชาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่2หัวที่3 .....                      | 42   |
| 4-2 ตัวอย่างค่าสัมบูรณ์ของ DAC ของชาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่2หัวที่3.....            | 43   |
| 4-3 เส้นตัวอย่างค่าเฉลี่ยของ H3.....  | 44   |
| 4-4 เส้นตัวอย่าง DAC peak, Avg line, Detection line และเส้นค่าเฉลี่ยของ H3..... | 45   |
| 4-5 ข้อมูลที่นำเข้ามาใน window size กำหนดความกว้างไว้ที่ 5.....                 | 46   |
| 4-6 ข้อมูลที่นำเข้ามาใน window size เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย.....                | 46   |
| 4-7 ข้อมูลใน windows ที่ถูกแบ่งแยกกลุ่มเพื่อนำไปคำนวณ.....                      | 46   |
| 4-8 Flow chart ของอัลกอริทึมการกำหนดระยะ FH.....                                | 47   |

## บทที่ 1

### บทนำ

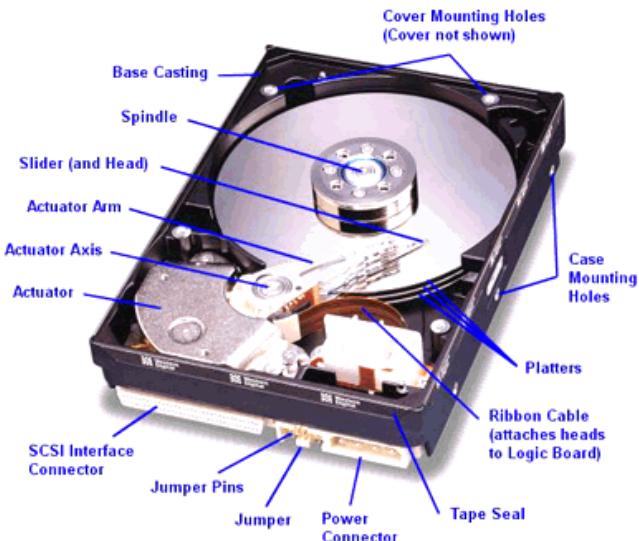
#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย

ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์มีบทบาทในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไปมากขึ้นเรื่อยๆ โดยฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญย่างหนึ่งสำหรับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นตัวเก็บบันทึกข้อมูล ภายในฮาร์ดดิสก์ประกอบด้วยแผ่นวงกลมสำหรับใช้บันทึกข้อมูลขนาดตั้งแต่ 1.8 – 3.5 นิ้วเรียงซ้อนกัน (แผ่นวงกลมนี้เรียกว่าดิสก์ disk) จะถูกบรรจุภายในกล่องปิดให้อากาศไม่เข้าได้บางส่วนและป้องกันฝุ่นที่จะเข้าไปถึง ชั้นดิสก์จะเรียกว่าด้วยกันเรียกว่า spindle ดังภาพประกอบ 1-1 ทำให้แผ่นดิสก์หมุนไปเนื่องจากการขับเคลื่อนด้วยความเร็วของมอเตอร์โดยมีหัวอ่าน-เขียนอยู่ที่แผ่นดิสก์ โดยปกติหัวฮาร์ดดิสก์จะมี 2 หัวต่อแผ่นดิสก์ 1 ajan สำหรับแผ่นดิสก์แต่ละแผ่น พื้นผิวของงานดิสก์ (เรียกว่า platter) จะถูกแบ่งเป็นวง ๆ ชึ่งเรียกว่าแทร็ค (track) หรือ cylinder

ในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ถูกพัฒนาให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ขนาดของฮาร์ดดิสก์ยังคงเดิมท่วงการสร้างฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงนั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้สร้างฮาร์ดดิสก์ความจุสูงขึ้นมา สำหรับวิธีการหนึ่งของการสร้างฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่มีความจุสูงคือการสร้างหัวอ่าน-เขียนที่มีระยะห่างของช่องว่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์กับแผ่นดิสก์ (ซึ่งเรียกว่า fly-height: FH ให้น้อยลง ในระดับนาโนเมตร :nm) เพื่อที่จะสามารถสร้างแม่เหล็กต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยได้มากขึ้นและเพิ่ม signal to noise ratio โดยจะต้องควบคุมระยะห่างของช่องว่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์กับแผ่นดิสก์ให้เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด soft error rate (SER) (SER คืออัตราข้อมูลที่ผิดพลาดต่อข้อมูลที่สมบูรณ์ โดยข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ซึ่งไม่เกี่ยวนেื่องกับข้อมูลที่ผิดพลาดทางกายภาพที่ไม่สามารถแก้ไขได้) ในระหว่างการอ่าน-เขียนข้อมูลและเพื่อป้องกันการเกิดการชนกันระหว่างแผ่นดิสก์กับหัวอ่าน-เขียน ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อฮาร์ดดิสก์ได้

เทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้สำหรับการสร้างหัวอ่าน-เขียนให้อยู่ใกล้กับแผ่นดิสก์คือการให้ความร้อนที่หัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ เมื่อหัวอ่าน-เขียนถูกให้ความร้อนจากชุดควบคุม โดยการป้อนกระแสไฟที่บลัดที่อยู่บริเวณหัวอ่าน-เขียน หัวอ่าน-เขียนที่ได้รับความร้อนจะขยายตัวเข้าใกล้แผ่นดิสก์ทำให้ระยะ FH ลดลง โดยเรียกส่วนควบคุมระยะห่างและความร้อนนี้อยู่เรียกว่า Thermal Fly-height Control (TFC)[1] โดยการคำนวณระยะระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์จะใช้การ

ให้ความร้อนไปที่หัวอ่าน-เขียนจนขยายตัวไปลึกสัมผัสกับแผ่นดิสก์แล้วจึงนำค่าพลังงานที่ได้จาก การให้ความร้อนนี้มาคำนวณเป็นระยะของ FH และเนื่องจากระยะห่างที่เหมาะสมสำหรับ ฮาร์ดดิสก์แต่ละรุ่นที่ผลิตออกมานั้น FH ถูกกำหนดไว้ที่ค่าสูงและเป็นค่าคงที่จากโรงงานเพื่อ ป้องกันการชนกันของหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์จึงทำให้การอ่านเขียนข้อมูลมีค่า error สูงด้วยเช่นกัน ทว่า FH นั้นยังสามารถปรับลดลงมาให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ค่า error ที่มีค่าน้อยลงได้โดยค่า error ที่ต่ำนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ดีขึ้นไปด้วย ถ้าหากว่า FH ต่ำลงมากเกินไป จะทำให้เกิดการชนกันของหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์ทำให้ดิสก์เกิดความเสียหายขึ้นดังนั้นการศึกษา และออกแบบอลกอริทึมที่สามารถควบคุม FH ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการชนกันของ หัวอ่าน-เขียนกับดิสก์และเพื่อให้ได้ SER ที่ดีนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับฮาร์ดดิสก์



ภาพประกอบ 1-1 ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ [17]

## 1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 1.2.1 In-Situ Flying Height Testing Technology [2]

สำหรับเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันระยะห่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์ อยู่ในระดับนาโนเมตรซึ่งระยะห่างนี้มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีการผลิตและทดสอบฮาร์ดดิสก์ โดยการทดสอบนั้นจะทดสอบโดยดูระยะห่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์เปลี่ยนแปลงตามตัวแปรใดบ้าง เพราะถ้าระยะห่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อการอ่าน-เขียนของฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากเทคโนโลยีของการวัดนั้นมีหลากหลายวิธีซึ่งค่อนข้างจะใช้งบประมาณในการลงทุนสูง ยกตัวอย่าง เช่นการใช้เดเซอร์ ดังนั้นจึงได้มีการเสนอวิธีในการวัดแบบใหม่คือ triple harmonics method ซึ่งมี ความสัมพันธ์ดังสมการที่(1)

$$FH = -\frac{3\lambda}{4\pi} \ln\left(\frac{V_3}{V_1}\right) \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$\lambda$  = wavelength of recording signal

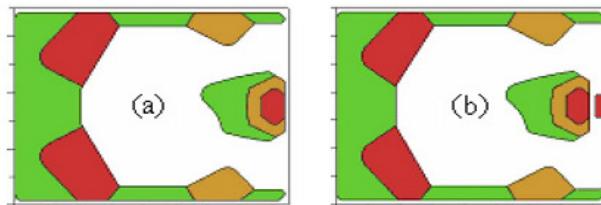
$V_1$  = intensity of the first harmonics read back signal

$V_3$  = intensity of the third harmonics read back signal

### 1.2.2 Low Flying-Height Slider with High Thermal Actuation Efficiency and

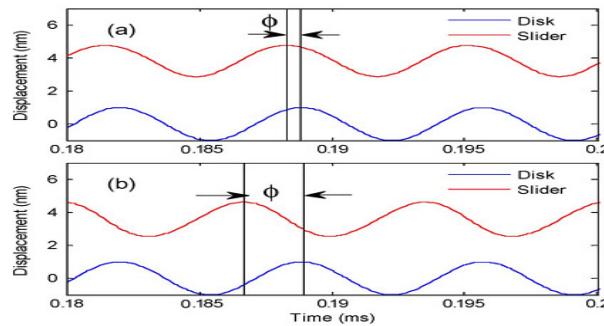
#### Small Flying-Height Modulation Caused by Disk Waviness [3]

สำหรับฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันนี้ยังคงมีระบบห่างระหว่างหัวอ่านและแผ่นดิสก์ (FH) น้อยเท่าไหร่ก็จะทำให้ความจุของฮาร์ดดิสก์มีความจุได้มากขึ้นไปอีกโดยจะรักษาระยะห่างระหว่างหัวอ่าน-เขียน และแผ่นดิสก์ให้คงที่เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการอ่าน-เขียนข้อมูล เทคนิกที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ Thermal Fly-height Control (TFC) วิธีนี้จะต้องรักษาระยะห่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์และกำจัดการสูญเสียแบบคงที่ได้เท่านั้น (static FH loss) ไม่สามารถรักษาระยะห่างแบบ dynamic FH loss ได้ เช่นตอนที่แผ่นดิสก์มีการสั่นไหว ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบ air bearing surface (ABS) สำหรับ thermal fly-height control ดังภาพประกอบ 1-2 และได้ผลลัพธ์ของการจำลองผลการทดลองดังภาพประกอบ 1-3 ดังจะเห็นได้ว่า air bearing surface แบบ Panda3[3] นั้นรักษา FH ตอนแผ่นดิสก์มีการสั่นไหวได้ดี



ABS designs of TFC sliders (a) Panda 3; and (b) Design A.

ภาพประกอบ 1-2 โครงสร้าง Slider ABS 5 (a) Panda 3, (b) Design A [3]



ภาพประกอบ 1-3 ตำแหน่งการบินของโครงสร้าง Slider ABS (a) Panda 3, (b) Design A [3]

### **1.2.3 Interface solution for writing-induced nano-deformation of slider body [4]**

เป็นการเพิ่มข้อมูลผลกระทบของความร้อนจากการเขียนข้อมูลลงไปในโนเมลค่า จำลองผลการทำงาน เนื่องจากความร้อนจากการเขียนข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมระยะ FH และยังได้กล่าวถึงแรงดันอากาศที่กระทำต่อ ABS ที่ทำให้ค่าของ heat transfer coefficient เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยจากโนเมลของการออกแบบเมื่อ slider มีแรงดันอากาศกระทำที่ค่าต่างๆ จะทำให้ค่า heat transfer coefficient เปลี่ยนแปลงไป

### **1.2.4 A MEMS-Based Monolithic Electrostatic Microactuator for Ultra-Low**

#### **Magnetic Disk Head Fly Height Control [5]**

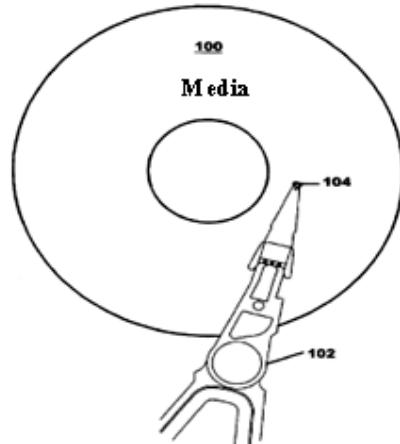
วิธีการที่กล่าวถึงเป็นการออกแบบด้วยกระดูก โดยมีแนวคิดที่ว่าการออกแบบนั้น จะต้องออกแบบ actuator ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความง่ายในการออกแบบและการสร้างขึ้นมา โดยหัวอ่าน-เขียนของชาร์ดดิสก์นั้นจะถูกติดไว้ที่ actuator ซึ่งแขวนอยู่บนสปริง เมื่อ actuator ทำงาน หัวอ่าน-เขียนจะขึ้นลงในแนวแกนที่ตั้งฉากระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์ โดยสามารถควบคุมระยะของหัวอ่าน-เขียนนี้ได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าผลสุดท้ายของการทดลองได้ระบุไว้ว่าวิธีนี้จะทำงานไม่ได้หากไม่มีเซ็นเซอร์ที่ใช้วัด FH ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาร์ดดิสก์นั้นจะไม่มีเซ็นเซอร์ FH ดังนั้นการใช้วิธีนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้จริงแต่ก็ยังสามารถหาวิธีที่แก้ไขได้คือ การใช้การอ่าน readback signal มาเพื่อกำหนด FH และจุดที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือ ESD ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วิธีนี้ควบคุมระยะของหัวอ่าน-เขียน เพราะถ้าหาก ESD เกิดขึ้นและการ shield อุปกรณ์ รอบข้างไม่ดีพอจะทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนนั้นเสียหายได้ และเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถ shield อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนค่างๆ ได้ทุกชิ้น ดังนั้นการป้องกันการการเกิด ESD เป็นวิธีที่ดีที่สุด หรืออาจใช้วิธีอื่นในการควบคุมระยะ FH แทนเพื่อป้องกัน ESD

### **1.2.5 Predictive Failure Analysis of Thermal Flying Height Control System and**

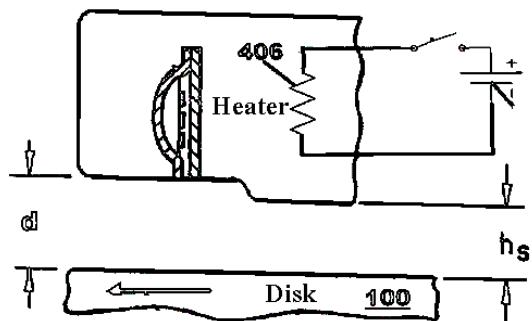
#### **Method TFC [6]**

มีประโยชน์ในการทำนายข้อขัดข้องของชาร์ดดิสก์ ดังรายละเอียดใน Us.Pat.No. 7,336,434 ภาพประกอบ 1-4 แสดง slider (หมายเลข 104) และ media (หมายเลข 100) ภาพประกอบ 1-5 แสดงภาพตัดขวางเฉพาะบริเวณหัวอ่านเมื่อไม่ให้ความร้อนซึ่งมีระยะ flying-height  $d$  มากกว่า nominal flying-height  $h_s$  ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้หัวอ่าน-เขียนแตะกับ media ในตอนเริ่มและสิ้นสุดการอ่าน-เขียน ภาพประกอบ 1-6 แสดงภาพตัดขวางเฉพาะบริเวณหัวอ่านเมื่อให้ความร้อน ซึ่งมีระยะ flying-height  $d$  มีค่าน้อยกว่า nominal flying-height  $h_s$  ซึ่งเพิ่มความหนาแน่นการอ่าน-เขียนดิสก์ได้มากขึ้น แต่การควบคุมระยะ flying-height ก็ยากขึ้นมากเช่นกัน โดยอัลกอริทึมในการทำนายข้อขัดข้องของชาร์ดดิสก์ ในกรณีที่ตัวให้ความร้อนแบบที่มีพกติกรรมการ

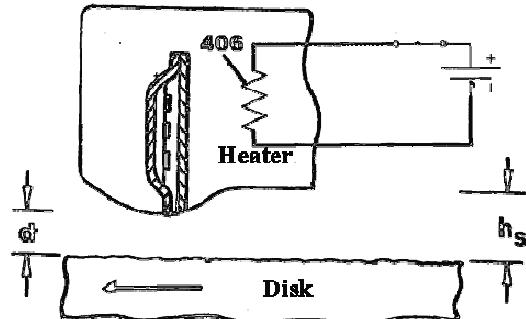
ลดลงของความด้านทานของหัวอ่าน-เขียน การเตือนข้อขัดข้องจะเกิดขึ้นเมื่อความด้านของ heater เพิ่มขึ้นทันทีทันใด 2-5% หรือ  $dR/dt$  เปลี่ยนเครื่องหมายจากลบเป็นบวก ในกรณีที่ตัวให้ความร้อนแบบที่มีพุติกรรมการเพิ่มขึ้นของความด้านทานของหัวอ่าน-เขียน การเตือนข้อขัดข้องจะเกิดเมื่อความด้านทานของตัวให้ความลดลงทันทีทันใด 2-5% หรือ  $dR/dt$  เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบ นอกจากนี้ random changes ของความด้านทานของตัวให้ความที่มากกว่าค่าความผิดพลาดที่กำหนดไว้ก็สามารถถูกนำมาเตือนข้อขัดข้องได้



ภาพประกอบ 1-4 หมายเลข 104 ตำแหน่งหัวอาร์ดิสก์และหมายเลข 100 ดิสก์ [6]



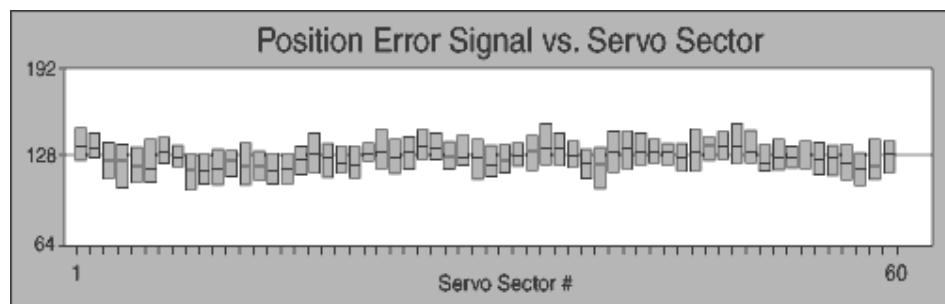
ภาพประกอบ 1-5 ภาพตัดขวางเฉพาะบริเวณหัวอ่าน-เขียนเมื่อไม่ให้ความร้อน [6]



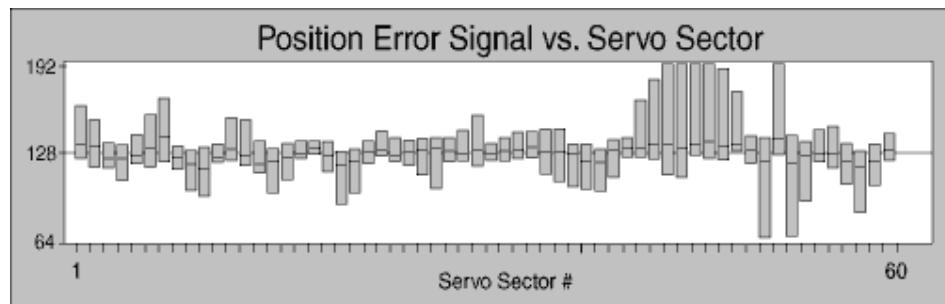
ภาพประกอบ 1-6 ภาพตัดขวางเฉพาะบริเวณหัวอ่าน-เขียนเมื่อให้ความร้อน [6]

### 1.2.6 Detection of Fly Height Change in a Disk Drive [7]

เป็นวิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหัวอ่าน-เขียนของฮาร์ดดิสก์โดยการตรวจสอบจากรูปแบบของสัญญาณ position error signal ภาพประกอบ 1-7, 1-8 แล้วนำค่าเทรส ไฮลและค่าเฉลี่ยของสัญญาณนำมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนอัลกอริทึมเพื่อที่จะทราบการเปลี่ยนแปลงของหัวอ่าน



ภาพประกอบ 1-7 ลักษณะสัญญาณ PES ของไคร์ฟปกติ [11]



ภาพประกอบ 1-8 ลักษณะสัญญาณ PES ของไคร์ฟผิดปกติ [11]

### 1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระยะ FH ที่มีผลจากตำแหน่งของดิสก์
- 1.2.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระยะ FH ที่มีผลต่อ SER
- 1.2.3 เพื่อศึกษาวิธีการควบคุม FH ให้ได้ค่า SER ที่ต่ำลง

### 1.4 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.3.1 เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง FH และ SER ของฮาร์ดดิสก์ที่มีส่วนควบคุม thermal fly-height control
- 1.3.2 เก็บข้อมูลเฉพาะฮาร์ดดิสก์ที่ส่วนประกอบเกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
- 1.3.3 สามารถควบคุม FH เพื่อให้ได้ค่า SER น้อยลงได้

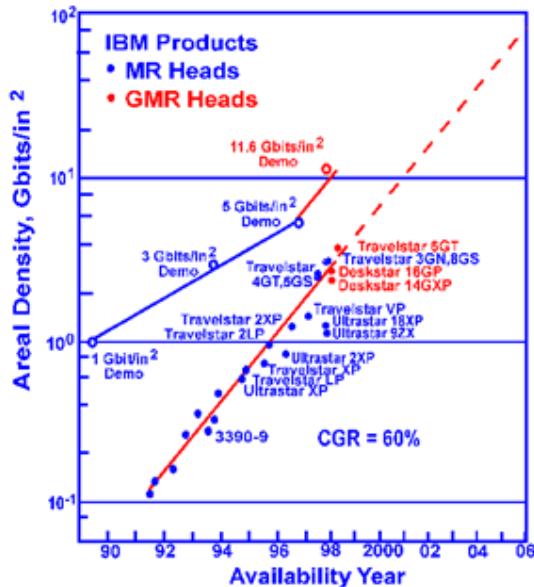
## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการ

ในการพัฒนาระเบียบวิธีสำหรับความคุณระยะหัวอ่าน-เขียน莎ร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูลสำหรับ莎ร์ดดิสก์ไดร์ฟจำเป็นที่จะต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ莎ร์ดดิสก์ไดร์ฟและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาระเบียบวิธีสำหรับความคุณระยะหัวอ่าน-เขียน莎ร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล

#### 2.1 ความเป็นมาของ莎ร์ดดิสก์ไดร์ฟ [8]

เทคโนโลยีของ magnetic hard disk drives (HDDs) ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยความสำเร็จของ HDDs มาจากการที่สามารถเพิ่มความจุได้มากขึ้นในขณะที่มีราคาลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนไบต์ต่อราคา โดยมีค่าหนึ่งที่ถูกเรียกว่า areal density คือ จำนวนที่เก็บไว้ในพื้นที่บน media ขนาด 1 ตารางนิ้ว ( bit per inch x track per inch ) การปรับปรุง areal density เป็นสาเหตุของการทำให้ราคาต่อเมกะไบต์ลดลงดังภาพประกอบที่ 2-1 ซึ่งแสดงอัตราการเติบโตของเทคโนโลยีของ magnetic head ของ HDD ในแต่ละปีโดยเห็นได้ว่า areal density นั้นจะมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเมื่อถึงจุดหนึ่งเทคโนโลยีของ magnetic head จะเปลี่ยนไปโดยจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งการพัฒนาที่สำคัญที่สุดนั้นอยู่ที่ magnetoresistive (MR) head โดยการพัฒนา MR นี้จะถูกพัฒนาเป็นจำนวนมากมาเป็น giant magnetoresistive (GMR) head โดยมีประวัติเบื้องต้นดังนี้ ในปี 1991 บริษัท IBM เป็นผู้นำในการใช้ MR heads สำหรับ HDD 1GB ใน莎ร์ดดิสก์ 3.5นิ้ว และต่อมาในปี 1994 IBM ได้ใช้ MR heads ในการวิจัยเพื่อที่จะทำให้ HDD มี areal density 3 Gbits/in<sup>2</sup> หลังจากนั้นประมาณ 3 ปีต่อมา หรือคือในปี 1997 IBM สามารถผลิต HDD ได้ที่ 3 Gbits/in<sup>2</sup> โดยใช้ MR heads หลังจากนั้นการพัฒนา MR heads ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็น GMR

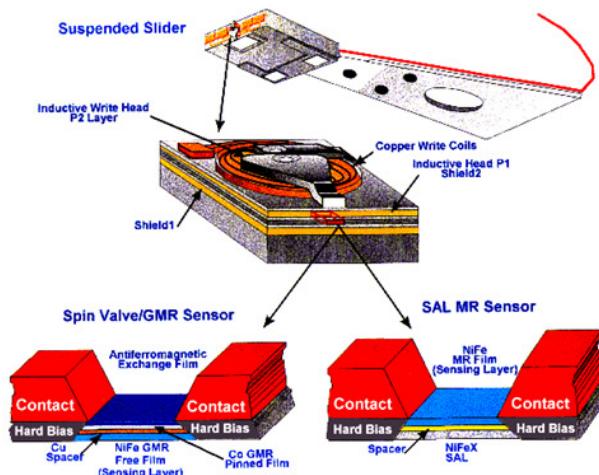


ภาพประกอบ 2-1 อัตราการเติบโตของเทคโนโลยีของ magnetic head ของ HDD [8]

## 2.2 เทคโนโลยีหัวอ่าน-เขียนอาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

### 2.2.1 หัวอ่าน-เขียนอาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

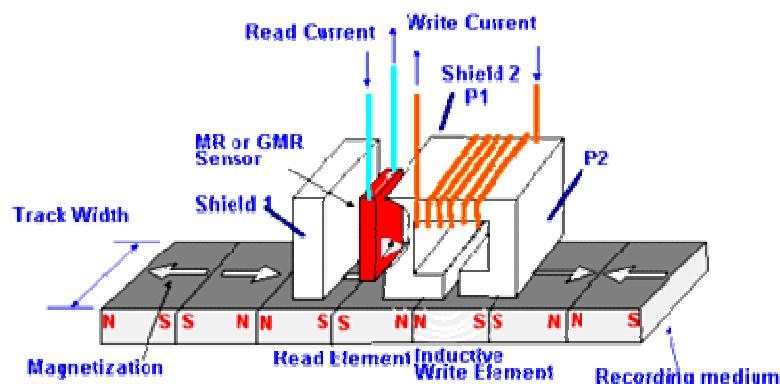
หัวอ่าน-เขียนเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของอาร์ดดิสก์ซึ่งการออกแบบส่วนหัวของอาร์ดดิสก์ประกอบด้วยส่วนของการอ่านและเขียนดังภาพประกอบ 2-2 โดยหัวอ่าน-เขียนจะติดอยู่ที่ส่วนปลายของ slider และ slider จะติดกับ suspension อีกชิ้นส่วนหนึ่ง โดยหัวอ่าน-เขียนจะอยู่ห่างกันในระยะหนึ่งซึ่งหัวอ่าน-เขียนอยู่ระหว่างชั้นของ shield ที่มีหน้าที่ป้องกัน magnetic fields ระหว่างหัวทั้งสอง ซึ่งสามารถผลิตส่วนของการอ่านเขียนแยกส่วน layer เพื่อให้จ่ายต่อการพัฒนาในภายหลัง



ภาพประกอบ 2-2 โครงสร้างของ MR และ GMR [8]

### 2.2.2 กระบวนการอ่าน-เขียนข้อมูล

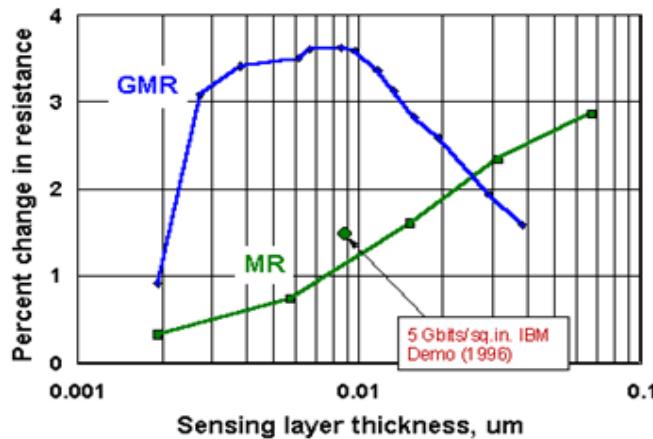
เมื่อสาร์คดิสก์เริ่มทำงานหัวอ่าน-เขียนของสาร์คดิสก์นั้นจะถอยอยู่บนดิสก์เนื่องจากมีการออกแบบหน้า air bearing surface ที่ด้านใต้ slider ทำให้หัวอ่าน-เขียนบินอยู่บนดิสก์โดยที่จะไม่สัมผัสกับหน้าของดิสก์ เมื่อเริ่มการเขียนข้อมูลจะมีการป้อนกระแสเพียงเล็กน้อยไปที่ write coil ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่ส่วนปลายของหัวเขียนและสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเหนี่ยวนำทำให้เกิดขึ้นที่ดิสก์ด้วยและการอ่านข้อมูลนั้นจะเกิดขึ้นในส่วนของ MR หรือ GMR เซนเซอร์โดยเมื่อเซ็นเซอร์เคลื่อนผ่านสนามแม่เหล็ก ความต้านทานของเซนเซอร์จะเปลี่ยนไปตามทิศทางของสนามแม่เหล็กทำให้สามารถรู้ถึงสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเขียนข้อมูลที่เกิดขึ้นได้



ภาพประกอบ 2-3 กระบวนการอ่าน-เขียนข้อมูล [8]

### 2.2.3 เทคโนโลยีของ MR และ GMR

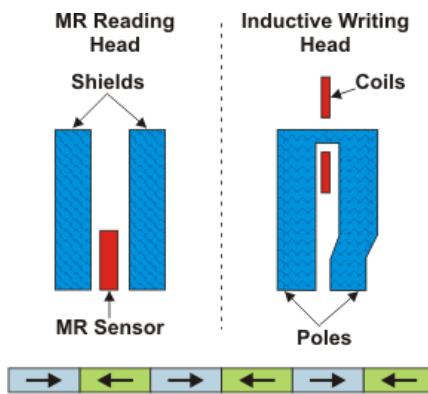
สำหรับเทคโนโลยีของ MR และ GMR เรื่องขนาดของเซนเซอร์ผู้ผลิตสาร์คดิสก์กล่าวไว้ว่าหากนำเซนเซอร์จำนวน 250,000 ตัวมาวางช้อนกันจะมีความสูงน้อยกว่าหนึ่งนิ้วซึ่งทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามีขนาดเล็กมากซึ่งความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนของเซนเซอร์ MR และ GMR คือการตอบสนองของสนามแม่เหล็กวัดจากเปลอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานโดยความต้านทานของ MR เซนเซอร์จะขึ้นกับคุณสมบัติของ sensing layer เป็นหลักสำหรับความต้านทาน GMR เซนเซอร์จะขึ้นกับธรรมชาติความต้านทานของอิเล็กตรอนด้วย โดยทั่วไป MR และ GMR เซนเซอร์จะประกอบด้วย layer ต่างๆ เป็นจำนวนมากแต่มี layer หนึ่งที่เหมือนกันคือ sensing layer จะตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กภายนอกโดยเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองไม่ต้องมีการกระตุ้นใดๆจากภายนอกประกอบ 2-4



ภาพประกอบ 2-4 การเปลี่ยนแปลงความต้านทานของ sensing layer MR และ GMR [8]

#### 2.2.4 โครงสร้างเบื้องต้นของ MR head [8, 9]

MR head มีอยู่สองส่วนหลักคือส่วนของการเขียนข้อมูลและส่วนของการอ่านข้อมูล ถูกออกแบบบนพื้นฐานความสามารถของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานตามสนามแม่เหล็ก โดยทั่วไปของหัวอ่านมีส่วนประกอบของ Ni 81% และ Fe 19% ซึ่งถูกเรียกว่า permalloy และส่วนของ MR head ในการเขียนข้อมูลจะมี inductive thin film head ในการสร้างสนามแม่เหล็กโดยการป้อนกระแสไฟที่ขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นระหว่างช่อง poles และเนื่องจาก head element อยู่ใกล้กับดิสก์มากทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทำให้มีสนามแม่เหล็กเกิดที่ดิสก์ด้วย เพราะดิสก์มีสารแม่เหล็กเคลื่อนอยู่ ซึ่งการเรียงตัวของแม่เหล็กจะเป็นแนวขนานกับดิสก์

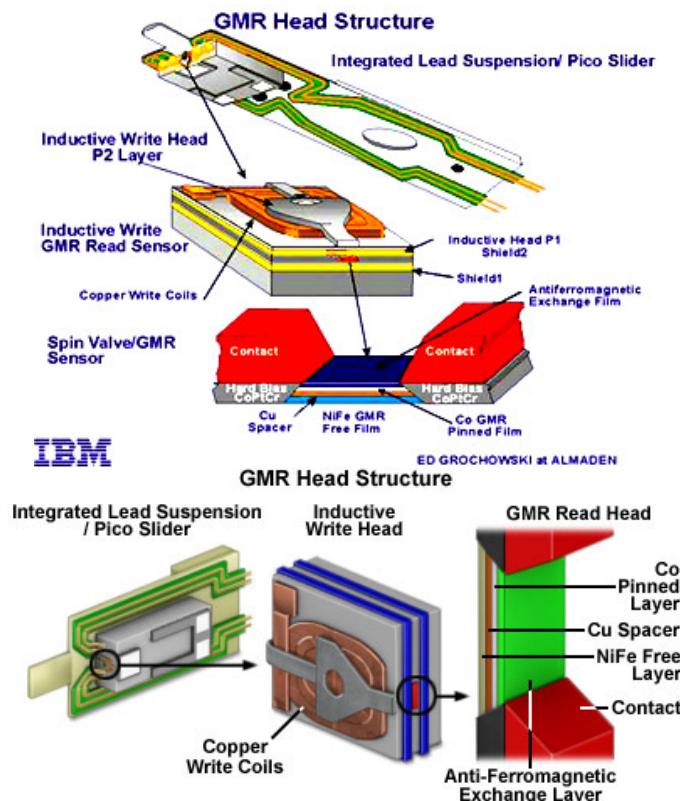


ภาพประกอบ 2-5 โครงสร้างเบื้องต้นของ MR head [9]

### 2.2.5 โครงสร้างเบื้องต้นของ GMR head [8, 9]

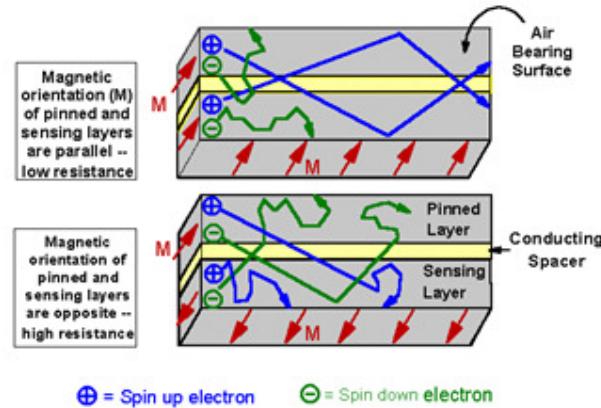
GMR head โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 layer ดังภาพประกอบ 2-6 ซึ่งwang ตัวเรียงช้อนตัวประกอบกันเหมือนเช่นวิช โดยแต่ละชั้นมีชื่อค้างนี้

1. Free layer หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ sensing layer พลิตามาจาก nickel-iron alloy อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อิสระในชั้นนี้เมื่อหัวอ่านเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก
2. Spacer เป็นชั้นที่ทำมาจากการดึงเป็นตัวขั้นกลางระหว่าง free layer กับ pinned layer เพื่อเป็นตัวขั้นกลางของสนามแม่เหล็กของชั้นห้องส่อง
3. Pinned layer ชั้นนี้ทำมาจากโคนบอดต์โดยสนามแม่เหล็กในชั้นนี้จะถูกวางแผนตัวอย่างคงที่ซึ่งได้รับพลมาจาก exchange layer และส่วนหนึ่งจาก free layer โดยในส่วนของ free layer จะทำให้ pinned layer มีค่าความต้านทานที่เปลี่ยนไปเมื่อเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็ก
4. Exchange layer ชั้นนี้ทำมาจาก antiferromagnetic ซึ่งเป็นโครงสร้างของ iron และ manganese สนามแม่เหล็กในชั้นนี้จะเรียงตัวอย่างคงที่เพื่อใช้ในการเหนี่ยวแน่นให้ชั้น pinned layer มีสนามแม่เหล็กเรียงตัวตามด้านที่อยู่ใกล้กัน



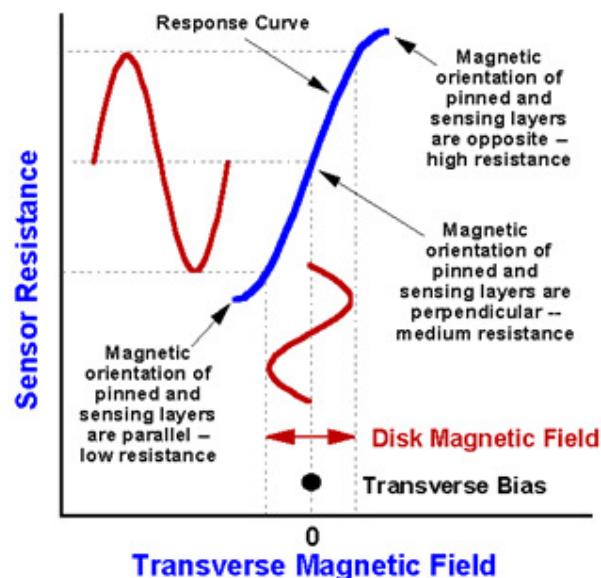
ภาพประกอบ 2-6 โครงสร้างเบื้องต้นของ GMR head [13]

การทำงานของ GMR นั้นมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็ก หากสนามแม่เหล็กบริเวณ free layer มีทิศเดียวกับ pinned layer จะทำให้ค่าความต้านทานของ GMR ลดลงและหากสนามแม่เหล็กบริเวณ free layer มีทิศตรงกันข้ามกับ pinned layer จะทำให้ค่าความต้านทานของ GMR เพิ่มขึ้น โดยการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนสามารถแสดงได้ดังภาพประกอบ 2-7



ภาพประกอบ 2-7 การเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนของ GMR sensor [8]

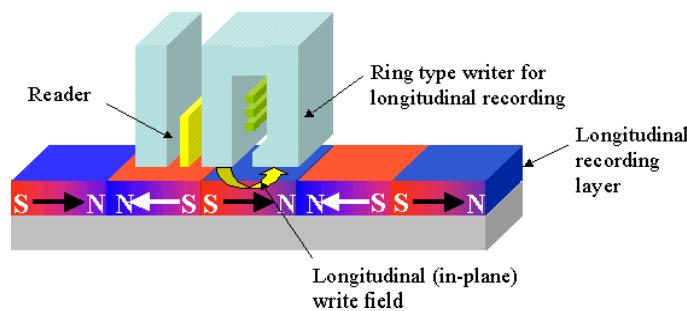
สาเหตุที่ GMR มีผลตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กและทำให้มีประสิทธิภาพดีกว่า MR เนื่องจากการออกแบบเป็น 4 layer ทำให้สามารถกำหนดกราฟของผลตอบสนองได้ดังภาพประกอบ 2-8 ซึ่ง กราฟของผลตอบสนองนี้ขึ้นอยู่กับความหนาที่เหมาะสมของ free layer



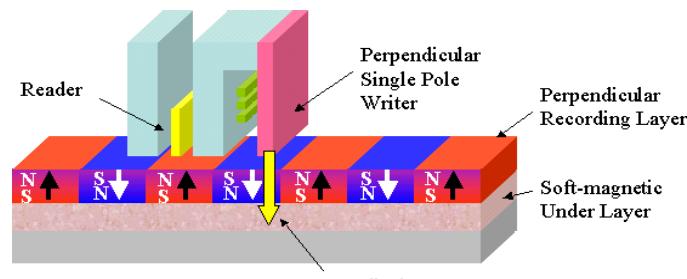
ภาพประกอบ 2-8 ผลตอบสนองของสนามแม่เหล็กต่อความต้านทานของ GMR [8]

### 2.2.6 การเขียนข้อมูลแบบ longitudinal และ perpendicular

ความแตกต่างของ longitudinal และ perpendicular recording ก็คือ longitudinal แม่เหล็กที่ถูกเขียนลงไปที่ดิสก์จะเรียงตัวตามแนวโน้มของดิสก์หรือก็คือขนานกับดิสก์ดังภาพประกอบ 2-9 ส่วน perpendicular นั้นแม่เหล็กที่ถูกเขียนลงไปที่ดิสก์จะถูกเขียนลงไปในแนวลึกหรือก็คือตั้งฉากกับดิสก์นั้นเอง โดยแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปของทิศขึ้นบนหรือลงล่างดังภาพประกอบ 2-10



ภาพประกอบ 2-9 การเขียนข้อมูลแบบ longitudinal [14]



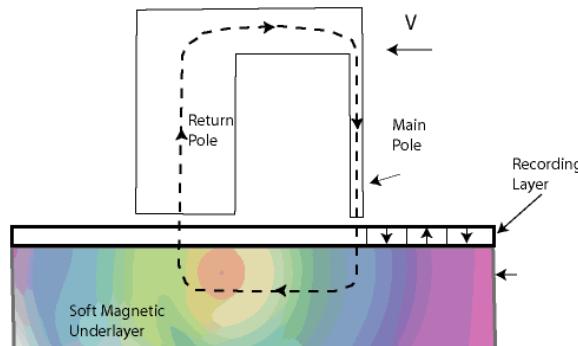
ภาพประกอบ 2-10 การเขียนข้อมูลแบบ perpendicular [14]

### 2.2.7 การเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีของ perpendicular

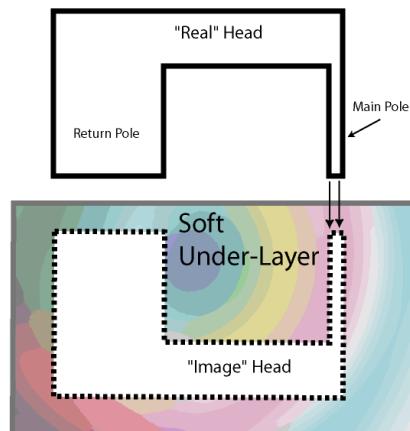
เทคโนโลยีของ perpendicular ถูกคิดค้นมาบนหลาบสิบปีแล้วหรือเกือบจะพร้อมกันกับเทคโนโลยีของ longitudinal แต่เนื่องจากในทางอุตสาหกรรมขณะนี้ประสบผลสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี longitudinal recording เพื่อผลิตชาร์ดดิสก์ได้และสามารถทำให้มีความจุสูงเพิ่มขึ้นมาได้อ่ายang ต่อเนื่องทำให้เทคโนโลยีของ perpendicular recording หยุดชะงักลง แต่มีอนาคตที่สดใสๆ หนึ่งที่เทคโนโลยีของ longitudinal recording ไม่สามารถสร้างให้เกิดชาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงขึ้นได้อีก เพราะหากจากข้อจำกัดของ paramagnetic effect ทำให้เทคโนโลยี perpendicular recording ถูกนำกลับมาพัฒนาอีกครั้ง

### 2.2.8 เทคโนโลยีของ perpendicular recording

เนื่องจากเทคโนโลยีของ perpendicular recording แตกต่างจาก longitudinal recording ดังนี้ โครงสร้างของหัวอ่าน-เขียนและโครงสร้างของดิสก์บางส่วนจึงได้แตกต่างออกไป ด้วยแสดงดังภาพประกอบ 2-11 แม่เหล็กที่ถูกเรียกว่า main pole ที่เกิดขึ้นจากหัวเขียนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ แต่ยังคงมีส่วนคล้ายกับแบบเก่าซึ่งเมื่อมีการเขียนข้อมูลลงไปที่ดิสก์โดย โครงสร้างของดิสก์จะมีชั้นๆหนึ่งเพิ่มเข้ามาหลังจากชั้น recording layer เรียกว่า soft magnetic under Layer (SUL) ทำหน้าที่ส่งผ่าน magnetic flux จาก main pole กลับไปที่ return pole ทำให้เกิดแม่เหล็กขึ้นในแนวเดิม คล้ายกับว่าเมื่อเปรียบกับ fringing field ของ longitudinal recording เป็นการผ่าครึ่งหัวเขียนแบบ longitudinal recording และฝังครึ่งที่เหลือไว้ใน SUL เมื่อฉันว่า SUL เป็น magnetic head อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือดังภาพประกอบ 2-12 โดยที่ปกตินามแม่เหล็กที่เกิดจาก longitudinal recording ผ่านอากาศในแนวโถกทำให้เกิดแม่เหล็กในแนวราบกับดิสก์ แต่ด้วยวิธี perpendicular recording สามารถแม่เหล็กจะผ่านอากาศในแนวตรงที่ลุ่มผ่าน recording layer และ SUL ที่กันอยู่ระหว่าง main pole และ return pole ทำให้เกิดเป็นแม่เหล็กแนวเดิมหรือตั้งฉากกับดิสก์เกิดขึ้น



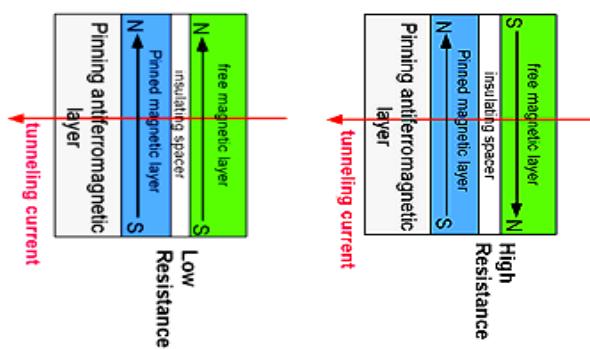
ภาพประกอบ 2-11 โครงสร้างหัวอ่าน-เขียนของเทคโนโลยี perpendicular [15]



ภาพประกอบ 2-12 โครงสร้างของ soft magnetic under layer [15]

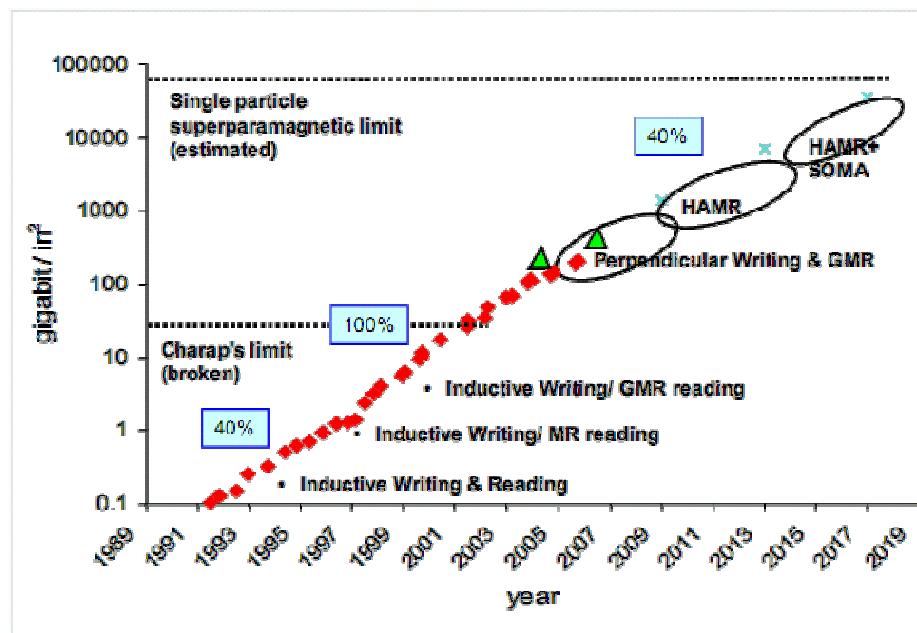
### 2.2.9 เทคโนโลยีของ tunnel magneto resistance (TMR)

โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 layer ซึ่งคล้ายกับ GMR เพียงแต่ต่างกันที่ชั้นของ spacer layer ของ GMR จะเปลี่ยนเป็น insulating ดังภาพประกอบ 2-13 เมื่อจากชั้นนี้เล็กมากจึงทำให้กระแสบางส่วนสามารถไหลผ่านได้ จำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการเรียงตัวแม่เหล็กของ layer ที่อยู่ติดกันกับชั้น insulating ทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนจึงสามารถใช้เป็นเซนเซอร์วัดสนามแม่เหล็กได้ โดยทั่วไปหลักการต่างๆจะคล้ายกับ GMR เพียงแต่ layer ของ TMR จะตั้งหากันดิสก์เมื่อ TMR เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กที่ลูกเบี้ยนในแบบ perpendicular recording สนามแม่เหล็กบริเวณชั้นของ free layer จะเรียงตัวตามสนามแม่เหล็กที่ TMR ผ่าน โดยหาก free layer เรียงตัวใดๆเดียวกับ pinned layer ค่าความต้านทานจะมีค่าต่ำ และหากเรียงตัวในทิศทางตรงกันข้ามค่าความต้านทานจะมีค่าสูง



ภาพประกอบ 2-13 โครงสร้าง tunnel magneto resistance layer [16]

สังเกตได้ว่าเทคโนโลยีของชาร์คดิสก์มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ areal density เพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันนี้ (2010) เทคโนโลยีของการบันทึกและอ่านข้อมูลของชาร์คดิสก์ได้มาอยู่ที่ perpendicular recording และ TMR ทำให้ areal density สูงขึ้นไปอีก หากแต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเทคโนโลยีนี้ก็จะถึงขีดจำกัดของมันหลังจากนั้นก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ ดังจะเห็นได้จากภาพประกอบ 2-14 ซึ่งเป็นกราฟที่ทางบริษัทซีเกทได้นำเสนอให้เห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีตั้งแต่อดีตจนถึงเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และเทคโนโลยีที่อาจจะเข้ามาแทนที่ perpendicular recording ในระยะเวลาอันใกล้ก็คือ heat assisted magnetic recording (HAMR) เมื่อจากการให้ความร้อนแก่ดิสก์ในขณะเริ่มกระบวนการเขียนจะทำให้สามารถเขียนแม่เหล็กที่เล็กกว่าการเขียนแบบ perpendicular recording ได้โดยแม่เหล็กที่ลูกสร้างขึ้นยังคงเป็นแนวเดิ่งหรือกีดังที่ตั้งหากันดิสก์เข่นเดียวกับ perpendicular recording



© 2008 Seagate Technology. All rights reserved.



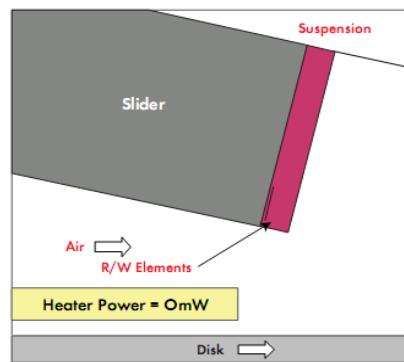
ภาพประกอบ 2-14 แนวโน้มเทคโนโลยีหัวอ่าน-เขียน [17]

## 2.3 เทคโนโลยีการกำหนดระยะ FH

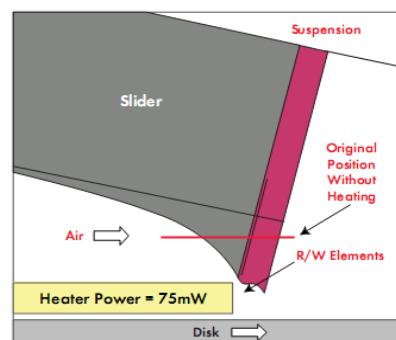
### 2.3.1 เทคโนโลยี thermal fly-height control (TFC) [1]

สำหรับการสร้างฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงนั้นมีความท้าทายเป็นอย่างมาก ต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างฮาร์ดดิสก์ความจุสูงขึ้นมา วิธีการหนึ่งคือการอ่าน-เขียนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพบนดิสก์ภายในช่วงของอุณหภูมิในขณะทำงาน และเงื่อนไขของ read/write duty cycle พารามิเตอร์ที่สำคัญที่มีผลต่อ error rate และความจุของฮาร์ดดิสก์ คือ ระยะห่างของช่องว่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนบนดิสก์กับดิสก์ซึ่งเรียกว่า fly-height จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับผลมาจากอุณหภูมิและ read/write duty cycle ซึ่งจะมีผลต่อช่องว่างของหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์ที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นการควบคุมระยะห่างระหว่างหัวอ่าน และแผ่นดิสก์ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมลดการอ่าน-เขียนซึ่งมีความจำเป็น ใช้เทคโนโลยี thermal flying-height control มาใช้ในการกำหนดระยะห่างระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์ โดยมีการติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิและชุดควบคุมกระแสน้ำที่ชุดหัวอ่าน ทำให้สามารถmonitor และควบคุมอุณหภูมิได้ หลักการทำงานคือที่หัวอ่าน-เขียนจะมีตัวทำความร้อน โดยตัวทำความร้อนจะเพิ่มความร้อนที่หัวอ่าน-เขียนทำให้หัวอ่าน-เขียนเมื่อได้รับความร้อนจะขยายออกและยึดตัวอกไปใกล้กับดิสก์ทำ

ให้ FH ลดลงดังภาพประกอบ 2-15 ตอนก่อนให้ความร้อน และภาพประกอบ 2-16 หลังให้ความร้อน เนื่องจากเทคนิคนี้จะใช้การวัด FH ตอนเริ่มต้นจากในสุดและนอกสุดของแผ่นดิสก์หลังจากนั้นจึงคำนวณและกำหนดค่า FH เป็นค่าคงที่ทำให้ FH นั้นประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากค่า FH ที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยระหว่างในสุดและนอกสุดของดิสก์เท่านั้น



ภาพประกอบ 2-15 หัวอ่าน-เขียนก่อนให้ความร้อน [1]



ภาพประกอบ 2-16 หัวอ่าน-เขียนหลังให้ความร้อน [1]

### 2.3.2 Touch down power (TDP)

คือกำลังงานที่ทำให้หัวอ่าน-เขียนของฮาร์ดดิสก์สัมผัสกับดิสก์โดยจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของความร้อนที่เกิดขึ้นที่หัวอ่าน-เขียน ทำให้มีอุ่นหัวอ่าน-เขียน ได้รับความร้อนจะขยายตัวยื้นออกมาเข้าใกล้และดิสก์แล้วจึงนำค่าที่ได้นี้ไปคำนวณเป็นระยะระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์ ยกตัวอย่างเช่น ฮาร์ดดิสก์มี TDP 70mW และมีอัตราส่วนของกำลังงานที่ให้ต่อการเขียนของหัวอ่าน/เขียนที่ 1mW/0.2nm ดังนั้นหากต้องการให้หัวอ่าน/เขียนอยู่ห่างจากดิสก์ 4nm จะต้องป้อนกำลังงานให้แก่หัวอ่าน/เขียนเท่ากับ  $70\text{mW} - (4/0.2) \text{ mW}$

## 2.4 การระบุประสิทธิภาพ/ตำแหน่งของหัวอาร์ดีสก์

### 2.4.1 Soft Error Rate (SER)

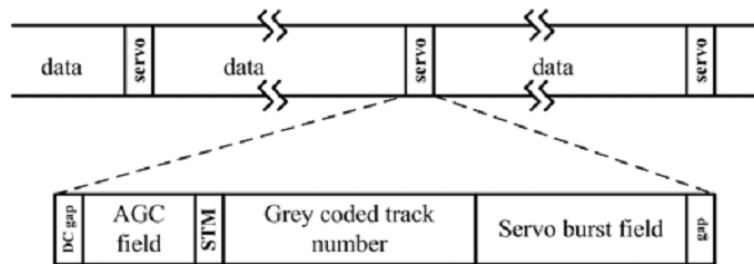
คือการวิเคราะห์หนึ่งของอาร์ดีสก์ที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการอ่านเขียนข้อมูลของอาร์ดีสก์ โดยจะมีการเขียนสัญญาณลงไปก่อนและอ่านสัญญาณกลับขึ้นมาหลายครั้งต่อการเขียนหนึ่งครั้งในพื้นที่หนึ่งหน่วย (100 sector) ซึ่งใน 100 sectors จะมีการเขียนสัญญาณลงไป 3 รอบ โดยในแต่ละรอบจะมีการอ่านสัญญาณขึ้นมา 30 ครั้ง โดยการทดสอบจะมีการเขียนสัญญาณทั้งหมด 3 รอบ เพราะฉะนั้นจะมีการอ่านข้อมูลทั้งหมด 9000 ครั้ง (100 sector x 3 timeWrite x 30 timeRead) ซึ่งในการอ่านข้อมูลกลับมาเนี้ยจะกำหนดค่าของ error correcting code (ECC) เท่ากับ 0 โดยการทดสอบนี้สามารถทำได้ทุกแทร็คของอาร์ดีสก์ หลังจากนั้นจึงตรวจสอบการอ่านค่าจากทั้งหมด 9000 ครั้งมี error เกิดขึ้นกี่ครั้งแล้วนำค่าวน SER โดยใช้สมการที่ (2.1)

$$\text{SER} = \log\{\text{Error count} / (9000 \times 512\text{Byte} \times 8\text{bit})\} \quad (2.1)$$

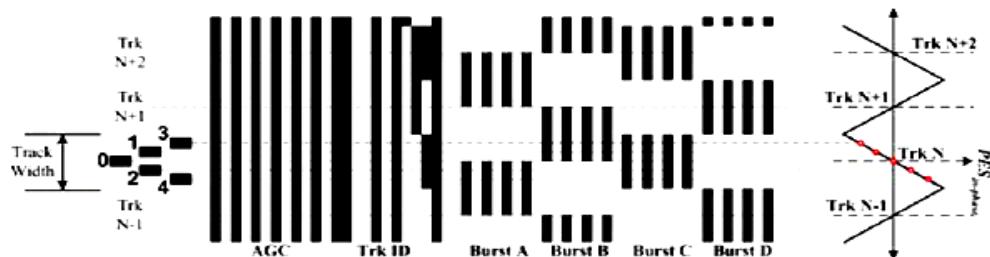
จะเห็นได้ว่า SER ที่ดีจะต้องมี error count น้อยมากๆ ซึ่งผลลัพธ์จากการคำนวณจะเป็นค่าติดลบยิ่ง มีค่าติดลบมากเท่าไหร่นั้นหมายถึง SER ยิ่งดีมากขึ้นไปด้วย

### 2.4.2 Position Error Signal (PES) [10]

ในแต่ละแทร็คของอาร์ดีสก์ไม่ได้มีแต่ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเขียนลงไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงข้อมูลของ servo ด้วยมีด้วยกัน 5 ส่วนสำคัญคือ DC-gap field, automatic gain control (AGC) field, servo timing mask (STM) field, grey coded track number field, position burst pattern field ดังภาพประกอบ 2-17 แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PES นั้นมีอยู่ด้วยกันสองส่วนคือ grey coded track number field และ position burst pattern field โดย grey coded track number field เป็นตัวระบุหมายเลขแทร็คเพื่อให้ตัวคอนโทรลรู้ว่าขณะนี้หัวอยู่ที่ตำแหน่งใด ส่วน position burst pattern field เป็นรูปแบบของเซอร์โวเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของหัวอ่านว่าอยู่ที่ตำแหน่งใดโดยใช้รูปแบบการเขียนเป็น pattern A B C D ดังภาพประกอบ 2-18

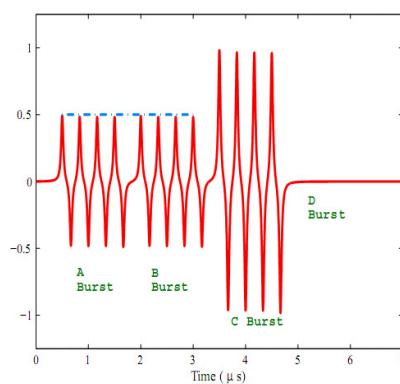


ภาพประกอบ 2-17 โครงสร้างของ track [10]

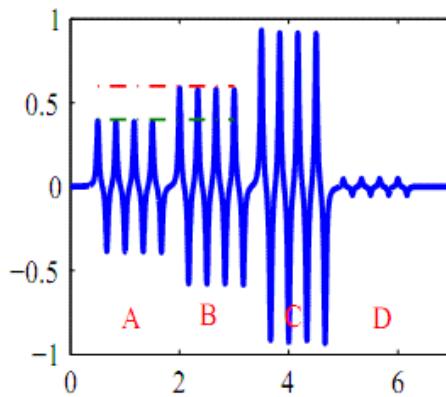


ภาพประกอบ 2-18 รูปแบบของ burst pattern [10]

เมื่อฮาร์ดดิสก์ทำงานหากหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์อยู่ที่ตำแหน่งที่ 0 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของแทร็ค N สัญญาณที่อ่านได้จาก burst C จะมีค่าสูงสุด burst D จะเป็น 0 ส่วน burst A, B จะมีค่าเท่ากันแต่น้อยกว่า burst C โดยรูปแบบของสัญญาณที่อ่านได้จากตำแหน่ง 0 สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบ 2-19 ถ้าหากว่าตำแหน่งของหัวอ่านไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่ 0 สัญญาณที่อ่านได้จาก Burst A B C D ก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย ยกตัวอย่างเช่นหากหัวอ่านอยู่ที่หมายเลข 1 สัญญาณที่อ่านได้จาก burst B ย่อมสูงกว่า burst A เพราะหัวอ่านอยู่ใกล้มากกว่าซึ่งตำแหน่งของหัวอ่านหมายเลข 1 ตามภาพประกอบ 2-18 สามารถแสดงรูปแบบสัญญาณได้ดังภาพประกอบ 2-20



ภาพประกอบ 2-19 สัญญาณที่ตำแหน่ง 0 [10]



ภาพประกอบ 2-20 สัญญาณที่คำแห่ง 1 [10]

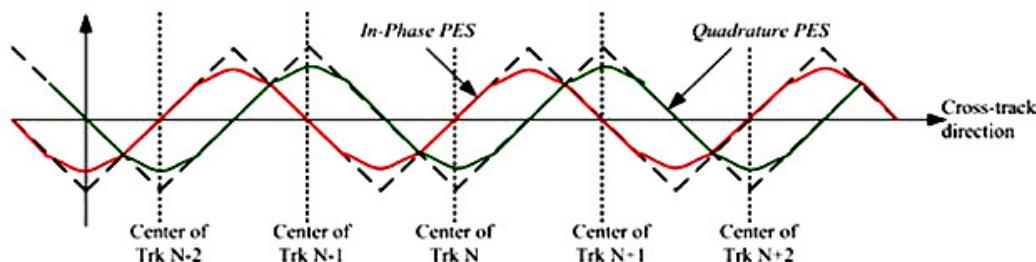
ดังนั้นคำแห่งที่หัวอ่านอยู่ห่างจากศูนย์กลางของแทร็คสามารถคำนวณได้จาก burst signal เหล่านี้ ดังนั้นคำแห่งศูนย์กลางของแทร็คสามารถคำนวณได้จากสัญญาณ burst เมื่อสัญญาณที่อ่านได้จาก burst A เท่ากับ burst B ซึ่งความแตกต่างของ A และ B เรียกว่า in-phase PES signal ดังสมการที่ (2.2)

$$\text{PES}_{\text{in-phase}} = A_A - A_B \quad (2.2)$$

เพื่อขึ้นบันคำแห่งของหัวอ่านในขณะที่อยู่บนแทร็คนอกจาก burst A, B แล้ว ยังใช้ burst C, D ด้วย โดยใช้หลักการเดียวกันกับ burst A, B เพียงแต่หากหัวอ่านอยู่กึ่งกลางแทร็คจะอ่านค่าสัญญาณ burst C ได้สูงสุดและไม่สามารถอ่านสัญญาณ burst D ได้ ซึ่งความแตกต่างของ C และ D เรียกว่า quadrature PES signal ดังสมการที่ (2.3)

$$\text{PES}_{\text{quadrature}} = A_c - A_d \quad (2.3)$$

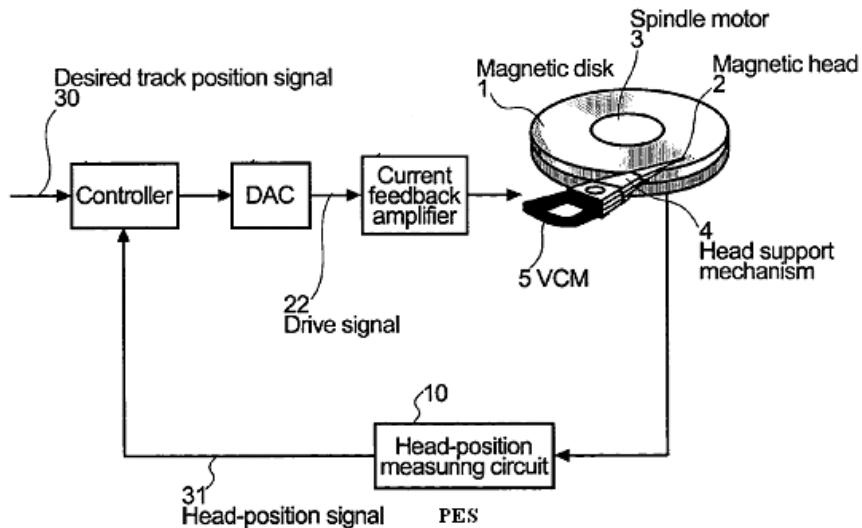
โดยหากใช้หัวอ่านของอาร์ดิสก์สกานอ่านค่าของแทร็คไม่เฉพาะจุดที่คิดว่าเป็นศูนย์กลางจะได้รูปสัญญาณดังภาพประกอบ 2-21 ซึ่งเฟสจะต่างกัน 90 องศา



ภาพประกอบ 2-21 สัญญาณ PES in-phase และ quadrature [10]

### 2.4.3 การควบคุมตำแหน่งหัวอ่าน-เขียนให้อยู่กึ่งกลางแทร็ค

กระบวนการของการอ่าน-เขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์เมื่อต้องการไปที่แทร็คที่ต้องการ จะเริ่มจากการหา track ID ซึ่งกำหนดโดย gray code number หลังจากนั้นเมื่อพบแทร็คที่ต้องการแล้ว จึงพยายามทำให้หัวอ่านอยู่กึ่งกลางของแทร็คโดยอ้างอิงตำแหน่งของหัวอ่านจากค่า PES ตามหัวข้อ 2.3.2 โดยกระบวนการของการให้หัวอ่านอยู่กึ่งกลางของแทร็คแสดงดังภาพประกอบ 2-22 เมื่อหัวอ่านเคลื่อนที่ไปถึงแทร็คที่ต้องการแล้วแต่หัวอ่านยังไม่อยู่ตรงกึ่งกลางของแทร็คซึ่งสามารถรับรู้ได้ด้วยระดับสัญญาณ PES จากนั้นส่วนของการควบคุม (controller) จะส่งคำสั่งให้กับ DAC เพื่อแปลงเป็นอนาล็อก digital to analog converter (DAC) ไปที่ voice coil motor (VCM) เพื่อปรับให้หัวอ่านอยู่ตรงกึ่งกลางของแทร็คหรือไกด์เคียงกึ่งกลางของแทร็คมากที่สุด จึงเริ่มอ่านหรือเขียนข้อมูล



ภาพประกอบ 2-22 การทำงานงานของ head position loop control [12]

## บทที่ 3

### การจำลองการทำงานและทดสอบตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหัวอ่าน-เขียน

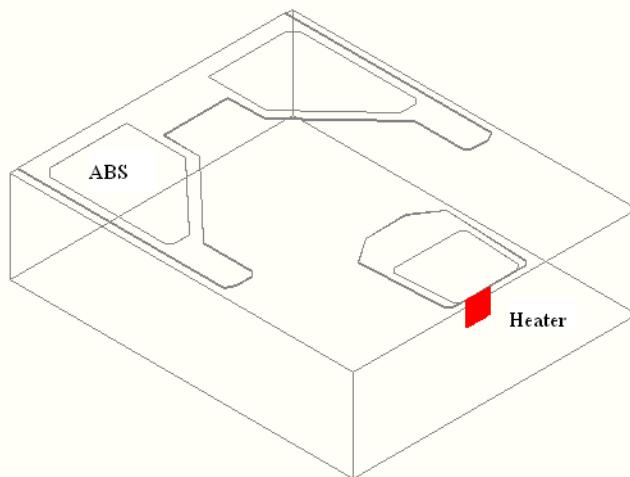
หลังจากได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทำให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกำหนดระเบียบและความสัมพันธ์ของ PES และ DAC ในการควบคุมหัวอ่าน-เขียนจึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจำลองการทำงานและทดสอบหาความสัมพันธ์และพฤติกรรมของหัวอ่าน-เขียนเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ดิสก์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระเบียบวิธีสำหรับความคุณระเบียบหัวอ่าน-เขียน ฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูลสำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในบทต่อไป

#### 3.1 การจำลองการทำงานการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียน

จุดประสงค์การจำลองการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียนเพื่อคุณวโน้มการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียนเมื่อถูกให้ความร้อนจากฮีตเตอร์โดยการจำลองการทำงานจะทดสอบความเป็นเชิงเส้นของการยืนตัวเมื่อได้รับความร้อน เนื่องจากการระบุระเบียบการบินของหัวอ่าน-เขียนคำนวนจากค่ากำลังงานที่ทำให้หัวอ่าน-เขียนสัมผัสดิสก์ซึ่งระบุไว้ในบทที่ 2 โดยถูกระบุเป็นเชิงเส้น ดังนั้นจึงจำลองการยืนตัวโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์อเลิมิเนตเพื่อคุณการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียนเป็นไปอย่างเป็นเชิงเส้นหรือไม่ โดยการทดสอบการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียนจะจำลองการทำงานโดยกำหนดค่าอุณหภูมิกาย nok เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งจากนั้นจึงปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของฮีตเตอร์เพื่อคุณการยืนตัวของหัวอ่าน-เขียน

##### 3.1.1 วิธีการจำลองการทำงาน

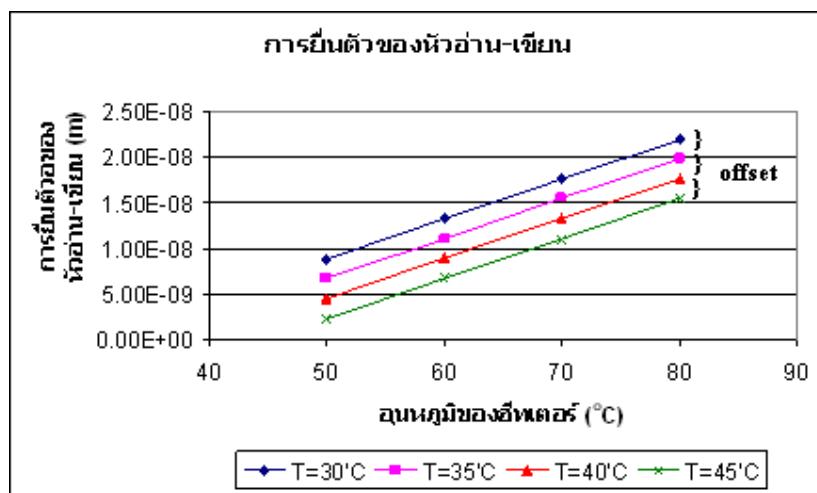
1. สร้างโครงสร้าง slider ชนิด femto ที่มีความกว้าง 0.7 mm ยาว 0.85mm สูง 0.22mm โดยมีฮีตเตอร์ติดอยู่บริเวณส่วนปลายซึ่งมีขนาดความกว้าง 0.003 mm ยาว 0.057mm สูง 0.057mm ดังภาพประกอบ 3-1
2. กำหนดอุณหภูมิกาย nok เป็น 30, 35, 40, 45 ( $^{\circ}\text{C}$ )
3. กำหนดอุณหภูมิฮีตเตอร์เป็น 50, 60, 70, 80 ( $^{\circ}\text{C}$ )
4. กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนคือ  $100,000 (\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k})$
5. เริ่มจำลองการทำงาน
6. บันทึกผล



ภาพประกอบ 3-1 โครงสร้าง slider

### 3.1.2 ผลการจำลองการทำงาน

ผลการจำลองการทำงานเพื่อยืนยันความเป็นเชิงเส้นของการยื่นตัวของหัวอ่าน-เขียน โดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นดังภาพประกอบ 3-2



ภาพประกอบ 3-2 การยื่นตัวของหัวอ่านเขียน

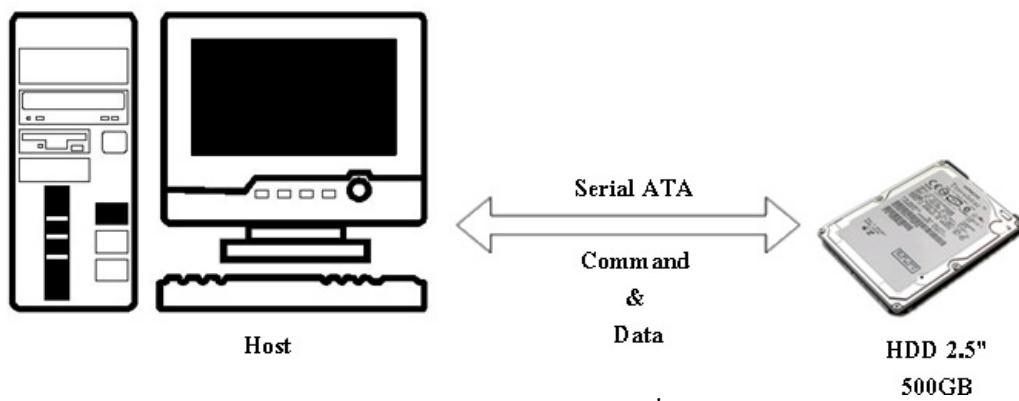
จากการทดสอบการยื่นตัวของหัวอ่าน-เขียนเพื่อยืนยันความเป็นเชิงเส้นของค่า TDP จากบทที่สองนี้ ผลการจำลองการทำงานเมื่อให้ความร้อนในแต่ละค่าที่ทำการทดสอบเพื่อคุณภาพยื่นตัว ผลการทดสอบทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าสามารถทำให้หัวอ่าน-เขียนยื่นตัวเป็นเชิงเส้นโดยผลของอุณหภูมิกายนอกมีผลต่อค่า offset ดังภาพประกอบ 3-2

### 3.2 การทดสอบความสัมพันธ์ PES และ DAC

จุดประสงค์การทดสอบนี้เป็นการทดสอบค่าพารามิเตอร์เกี่ยวกับการควบคุมตำแหน่ง การระบุตำแหน่งและกำลังงานที่ป้อนให้แก่หัวอ่าน-เขียน เพื่อนำพารามิเตอร์เหล่านี้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยดูความสัมพันธ์ของการลดระยะ FH จนใกล้สัมผัสดิสก์กับพารามิเตอร์ที่กล่าวถึงมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับระยะ FH หรือไม่จากนั้นจึงเลือกใช้พารามิเตอร์ที่เกี่ยวของที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดมาใช้ในการออกแบบอัลกอริทึม

### 3.3 ภาพรวมของระบบที่ใช้ในการทดสอบ

ระบบที่ใช้ทดสอบแสดงให้เห็นภาพรวมของอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทดสอบที่เกี่ยวกับการทดลองทั้งหมดในบทนี้โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารดังภาพประกอบ 3-3 ประกอบด้วย host ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่บรรจุซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการทดสอบ ใช้ในการส่งข้อมูลคำสั่งการทดสอบจาก host ไปยังฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและรับข้อมูลที่ได้จากการทดสอบจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมายัง host เพื่อคุณลักษณะของการทดสอบในแต่ละคำสั่งหรือในแต่ละเงื่อนไขในการทดสอบผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ serial ATA โดยภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจะมีบูตloaderที่สามารถรับรู้คำสั่งที่ถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลที่ต้องการกลับไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โดยฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ใช้ในการทดสอบนี้เป็นของบริษัท希捷 โกลบล อัตโนมัติ ประเทศไทย จำกัด รุ่น 2.5 นิ้วขนาดความจุ 500 กิกะไบต์



ภาพประกอบ 3-3 ภาพรวมของระบบที่ใช้ทดสอบ

### 3.4 การทดสอบระยะ FH ของหัวอ่าน-เขียนาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพื่อคุณภาพสูงในแต่ละระยะการบินที่ต้องการ

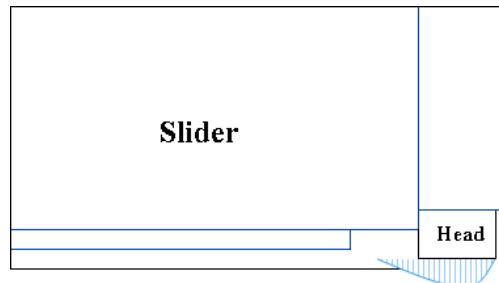
ในการทดสอบหาระยะการบินของหัวอ่าน-เขียนาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพื่อคุณภาพสูงในแต่ละระยะการบินที่ต้องการ โดยใช้เทคโนโลยี thermal fly-height control ใน การวัดระยะ FH ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีการใช้วิธีของการหาทำลังงานที่ป้อนให้หัวอ่าน-เขียนสัมผัสกับดิสก์โดยเรียกทำลังงานนี้ว่า TDP ทำลังงานนี้จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณเป็นระยะ FH

#### 3.4.1 วิธีการทดสอบ

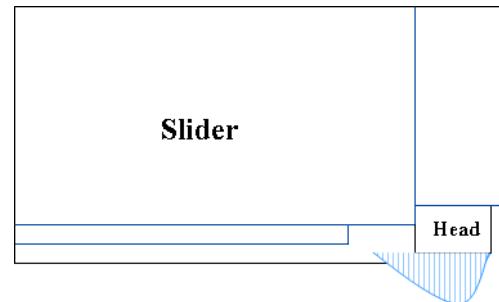
- กำหนดจุดทดสอบที่วงใน, วงนอก, กึ่งกลาง, ระยะกึ่งกลางจากระยะกึ่งกลาง มาซึ่งวงนอกและระยะกึ่งกลางจากระยะกึ่งกลางมาซึ่งวงใน ซึ่งกำหนดเป็นหมายเลข cylinder โดยประมาณ ได้ดังนี้ -500(วงนอก), 42500, 85000(กึ่งกลาง), 127500, 152031 (วงใน) โดยทดสอบ หัวอ่าน-เขียนาร์ดดิสก์ทั้งหมด 8 หัวจากไม้เดลรุ่นเดียวกันทั้งหมดซึ่งอยู่ภายใต้การทดสอบด้วย

- เริ่มให้ความร้อนจาก 0mW จนกระทั่งซอฟท์แวร์ตรวจจับการสัมผัสกับดิสก์ โดยการให้ความร้อนแก่หัวอ่าน-เขียนาร์ดดิสก์ไดร์ฟหัวอ่าน-เขียนจะเริ่มขยายตัวตามสภาพประกอบ 3-2 เมื่อหัวอ่านได้รับความร้อนมากขึ้นจากชุดควบคุมความร้อนจะเริ่มขยายตัวตามทำลังที่ป้อนให้กับหัวอ่าน-เขียนาร์ดดิสก์จนกระทั่งหัวอ่านใกล้สัมผัสกับดิสก์จึงได้ค่า TDP

- บันทึกค่าในแต่ละครั้งของการวัด



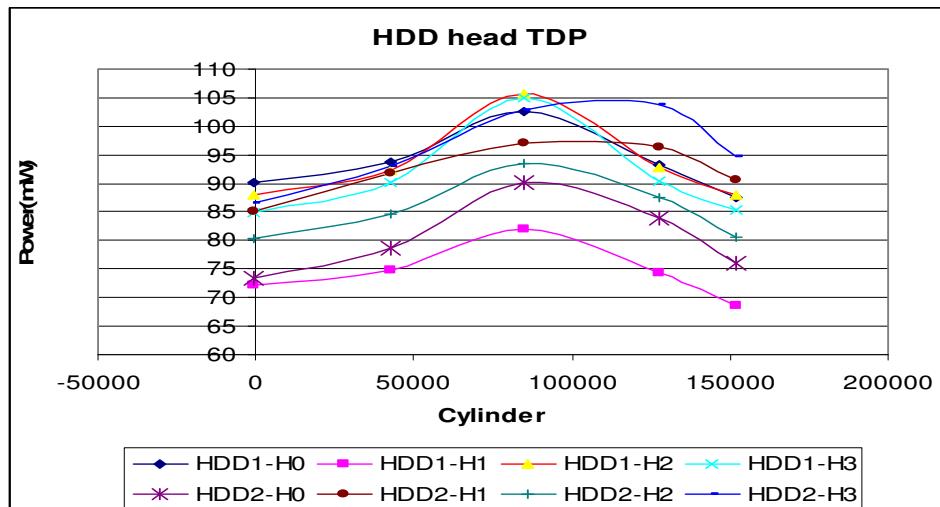
ภาพประกอบ 3-4 เริ่มให้ความร้อนที่หัวอ่าน-เขียน



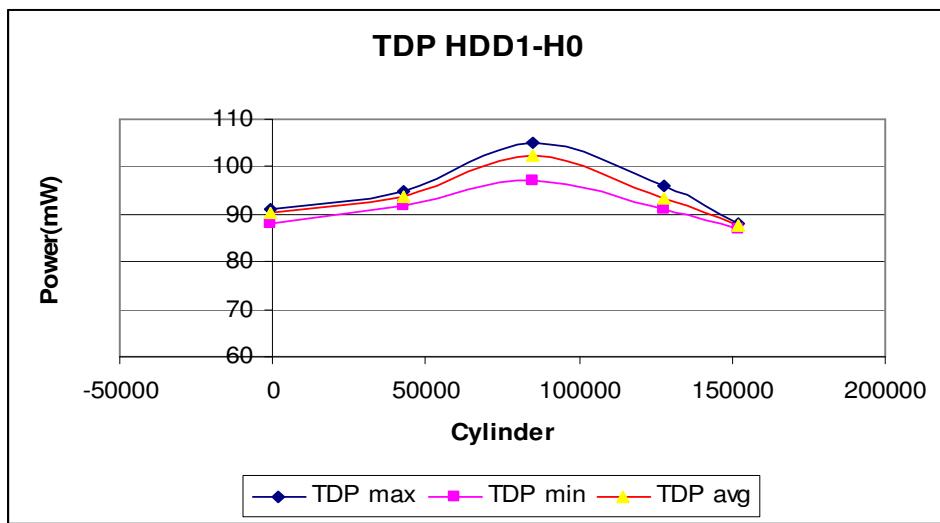
ภาพประกอบ 3-5 หัวอ่าน-เขียนขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น

### 3.4.2 ผลการทดสอบ FH

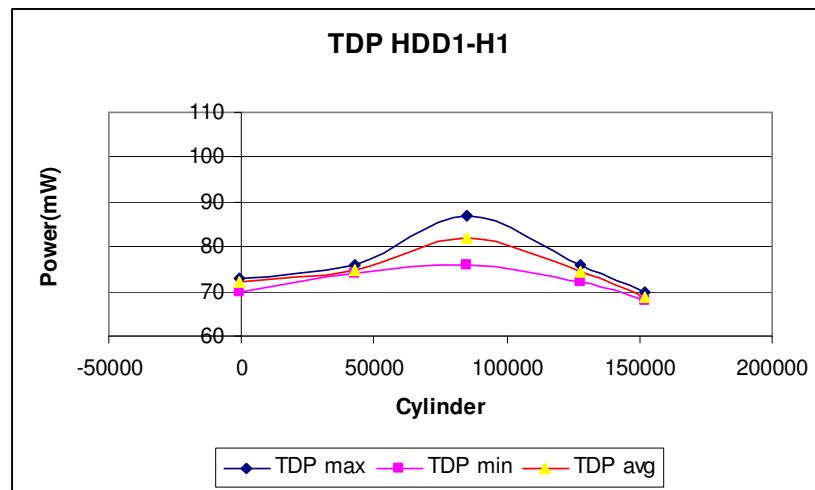
ผลการทดสอบการหาระยะการบินของหัวอ่าน-เขียนเพื่อที่จะได้ทราบระยะของ FH ที่แต่ละตำแหน่งของดิสก์โดยผลของการทดสอบแสดงให้เห็นตามภาพประกอบ 3-6 ถึงภาพประกอบ 3-14



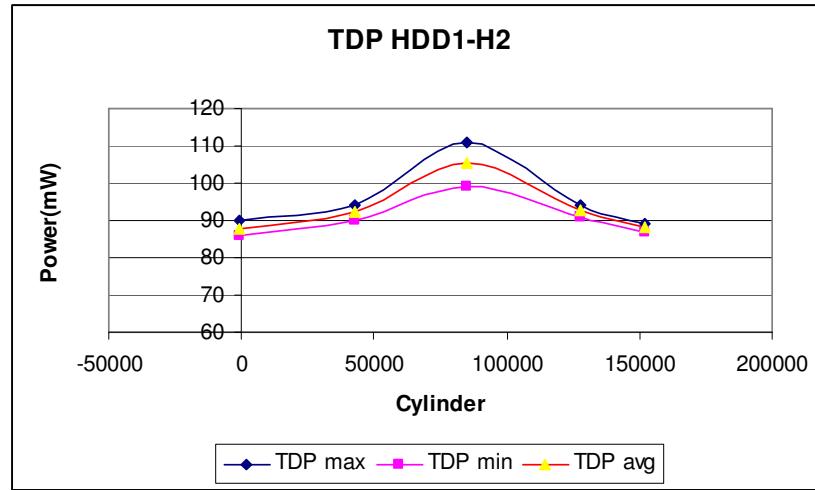
ภาพประกอบ 3-6 กำลังงานที่ทำให้หัวอ่าน-เขียนสัมผัสดิสก์



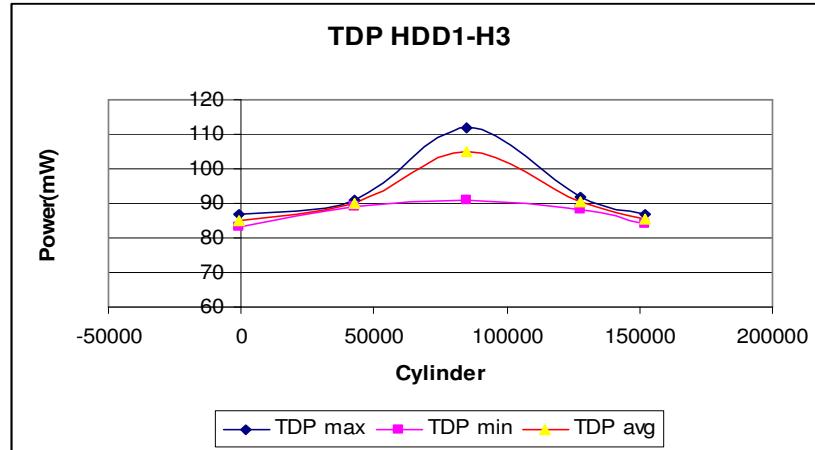
ภาพประกอบ 3-7 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H0 สัมผัสดิสก์



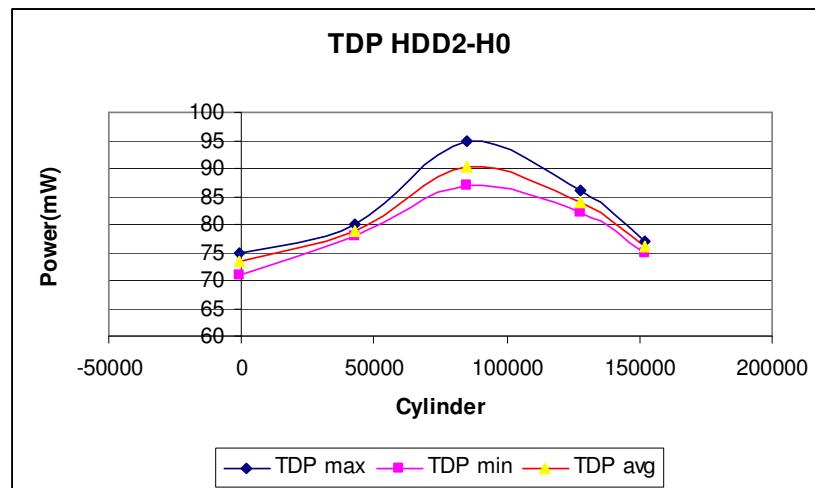
ภาพประกอบ 3-8 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H1 สัมผัสดิสก์



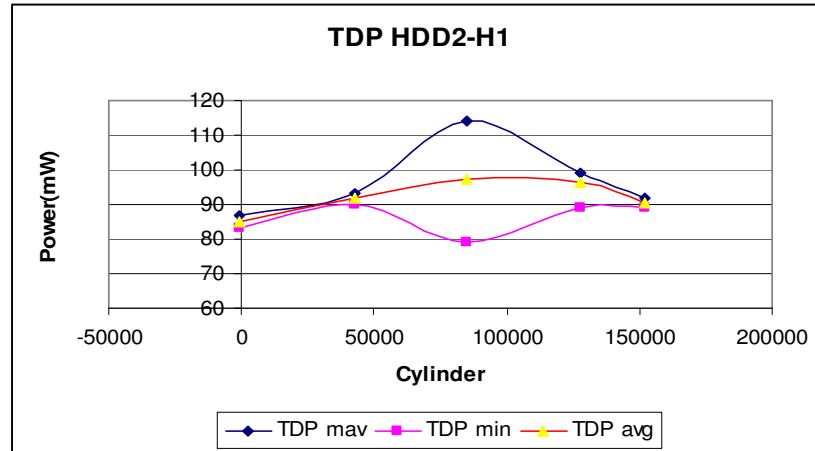
ภาพประกอบ 3-9 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H2 สัมผัสดิสก์



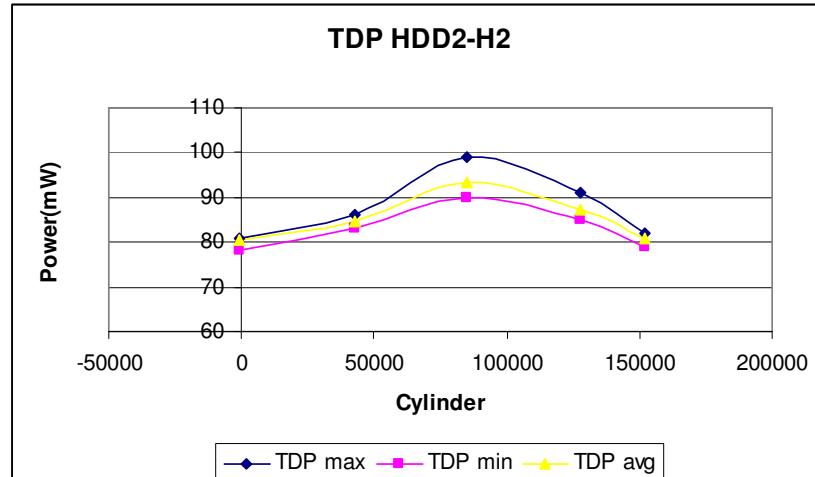
ภาพประกอบ 3-10 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD1-H3 สัมผัสดิสก์



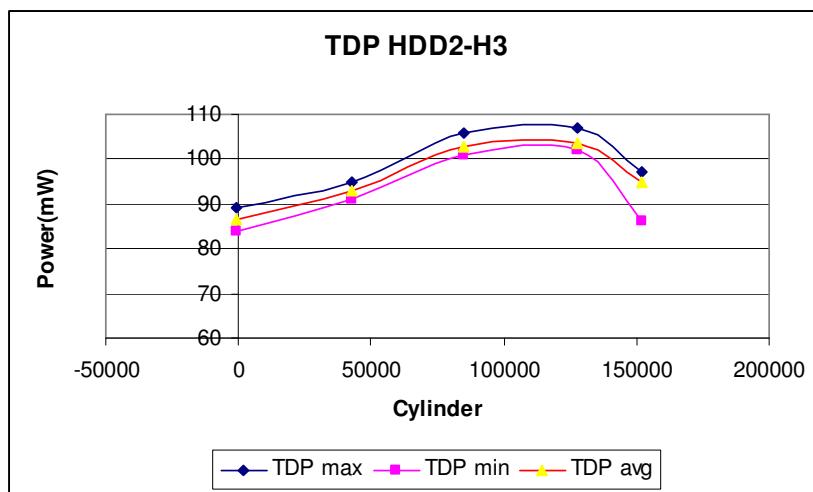
ภาพประกอบ 3-11 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H0 สัมผัสคิสก์



ภาพประกอบ 3-12 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H1 สัมผัสคิสก์



ภาพประกอบ 3-13 กำลังงานสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H2 สัมผัสคิสก์



ภาพประกอบ 3-14 กำลังงานสูงสุดต่่าสุดและค่าเฉลี่ยจากการวัดที่ HDD2-H3 สัมผัสดิสก์

ผลจากการทดสอบระยะ FH ของหัวอ่าน-เขียนที่ผลิตมาจากรุ่นเดียวกันเมื่อทดสอบด้วยเทคโนโลยี TFC เพื่อหาระยะ FH นั้นได้ผลการทดลองที่มีความแตกต่างกันของระยะ FH อยู่ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าหน้า ABS จะเป็นแบบเดียวกันเมื่อนำมาประกอบเป็นหัวอ่าน-เขียนที่ติดอยู่กับ suspension แล้วระยะการบินของแต่ละหัวอ่าน-เขียนนั้นแตกต่างกันดังจะเห็นได้จากภาพประกอบ 3-6 และที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือการวัดด้วย TFC นั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดด้วย TFC ยังมีค่าความแปรปรวนค่อนข้างสูงดังนั้นการกำหนดระยะจาก TFC นี้ประสิทธิภาพที่ได้อาจไม่สูงมากนัก ซึ่งเห็นได้จากความแปรปรวนที่เกิดขึ้นได้ที่บริเวณกึ่งกลางของดิสก์ แต่ประเด็นหลักของการใช้ TFC ในงานวิจัยนี้เพียงต้องการเพิ่มระยะ FH ให้เข้าใกล้ดิสก์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วดูความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตำแหน่งของหัวอ่าน-เขียนว่าจะสามารถควบคุมให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้ดีเพียงใดและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านี้จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาเป็นระบบเบียนวิธีที่ควบคุมระยะ FH ได้หรือไม่

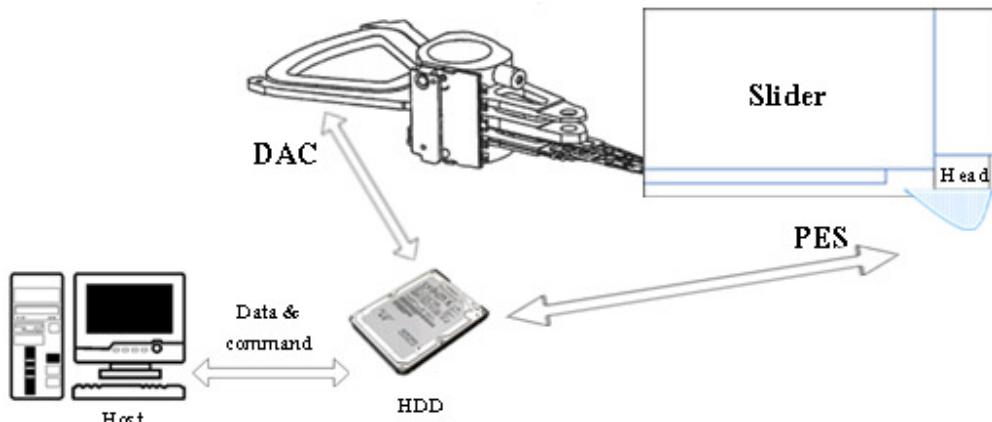
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตำแหน่งให้หัวอ่าน-เขียนที่ได้ศึกษาจากบทที่ 2 นั้นคือ SER, DAC และ PES ซึ่งการทดสอบต่อไปคือการให้ความร้อนไปที่หัวอ่าน-เขียนฯเพื่อทดสอบ FH แล้วดูความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแปรเหล่านี้

### 3.5 การทดสอบ PES และ DAC

การทดสอบ PES และ DAC values นั้นเป็นการทดสอบเพื่อคุณภาพสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำให้หัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้ดิสก์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยใช้การให้ความร้อนจนกระตุ้นการขยายตัวของหัวอ่าน-เขียน หลังจากนั้นจึงนำผลที่ได้มามวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระยะ FH โดยการทดสอบนี้จะทำการทดสอบความถ่วงไปทั้งสองการทดสอบเนื่องจาก PES และ DAC สามารถวัดค่าการทดสอบด้วยซอฟต์แวร์การทดสอบได้พร้อมๆกัน การวัดด้วยซอฟต์แวร์ทดสอบนี้จะเป็นการวัดเมื่อมีการเพิ่มกำลังงานทุกๆ 1mW จะมีการบันทึกหนึ่งครั้ง

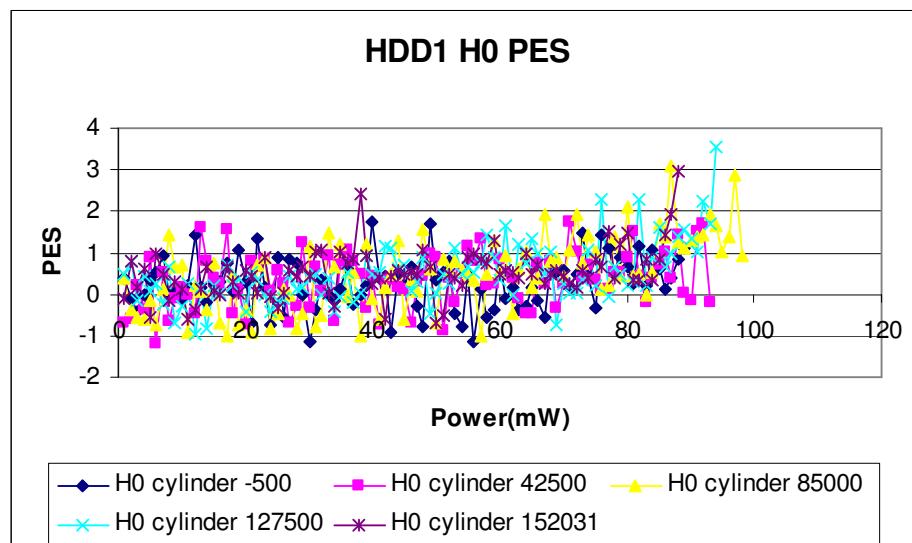
#### 3.5.1 วิธีการทดสอบ

- กำหนดค่าทดสอบที่วงใน, วงนอก, กึ่งกลาง, ระยะกึ่งกลางจากระยะกึ่งกลางมาซึ่งวงนอกและระยะกึ่งกลางจากระยะกึ่งกลางมาซึ่งวงใน ซึ่งกำหนดเป็นหมายเลข cylinder โดยประมาณได้ดังนี้ -500(วงนอก), 42500, 85000(กึ่งกลาง), 127500, 152031 (วงใน) โดยทดสอบหัวาร์ดดิสก์ทั้งหมด 8 หัวจากโมเดลรุ่นเดียวกันทั้งหมดซึ่งอยู่ภายใต้รัศมีการทดสอบตัว
- เริ่มให้ความร้อนที่หัวอ่านาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยแต่ละขั้นของการเพิ่มความร้อน (1mW) จะบันทึกค่า PES และ DAC ดังภาพประกอบ 3-15 การบันทึกผลการทดสอบนี้จะกระทำไปจนกระตุ้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดสอบตรวจสอบการทำงานของหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์
- ผลของการบันทึกค่าจะถูกเก็บไว้ใน log file เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น

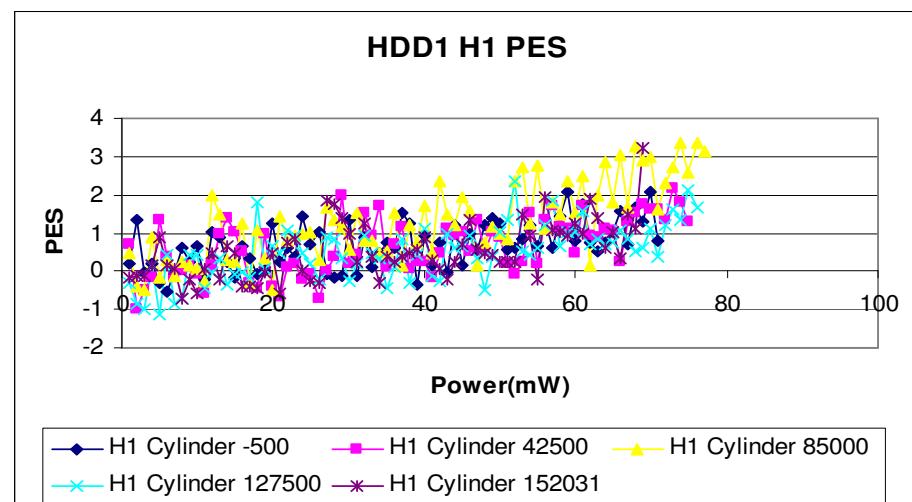


### 3.5.2 ผลการทดสอบ PES

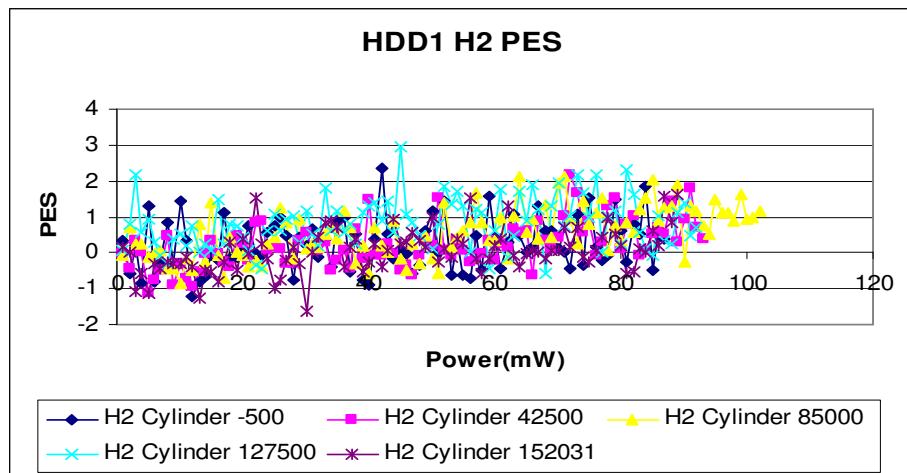
ผลการทดสอบสอน PES ซึ่งกีดคืบค่าที่ระบุตำแหน่งของหัวอ่าน-เขียนจากกึ่งกลางของแทร็ค ซึ่งหากหัวอ่าน-เขียนอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีค่า PES จะเท่ากับกับศูนย์ หากเบี่ยงซ้ายหรือขวา ค่า PES จะแสดงค่าเป็นบวกหรือลบดังภาพประกอบ 3-16 - 3-23 โดยผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าเมื่อ ระยะ FH เข้าใกล้คิดสก์มากขึ้นการรักษาตำแหน่งของหัวอ่าน-เขียนเริ่มทำได้ยากมากขึ้นสังเกตได้จาก PES เคลื่อนที่เบี่ยงซ้ายหรือขวาไปเรื่อยๆ



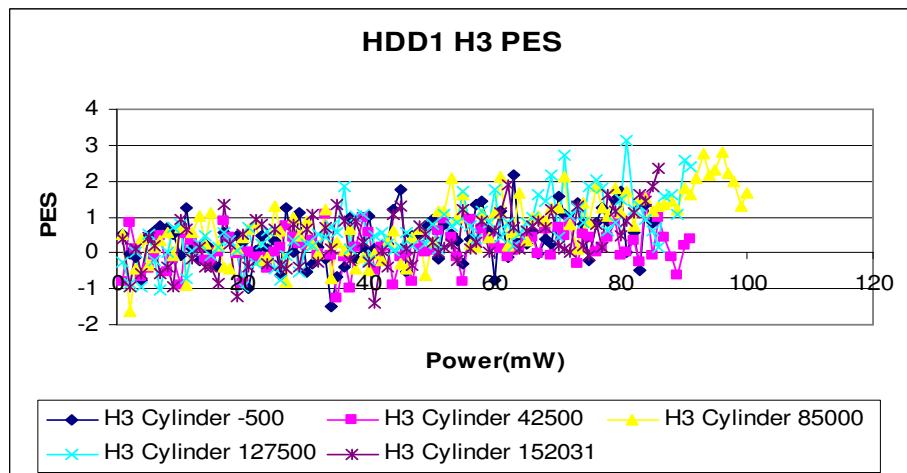
ภาพประกอบ 3-16 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



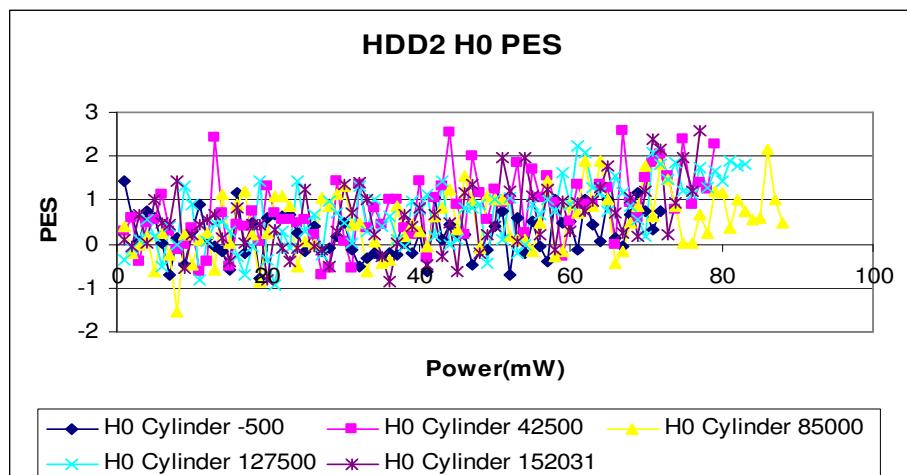
ภาพประกอบ 3-17 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



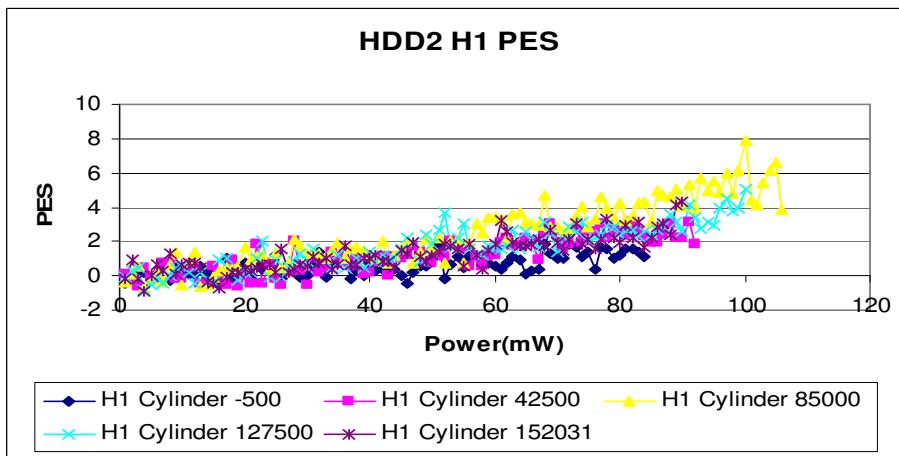
ภาพประกอบ 3-18 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



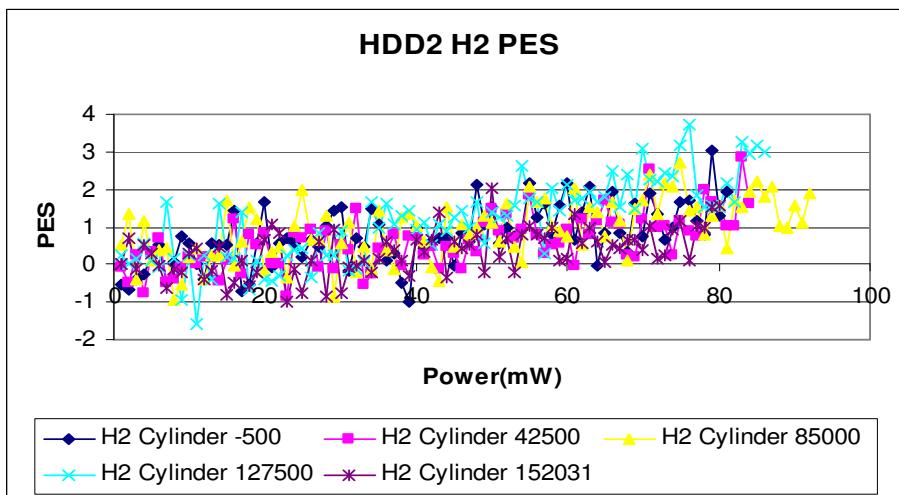
ภาพประกอบ 3-19 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD1 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



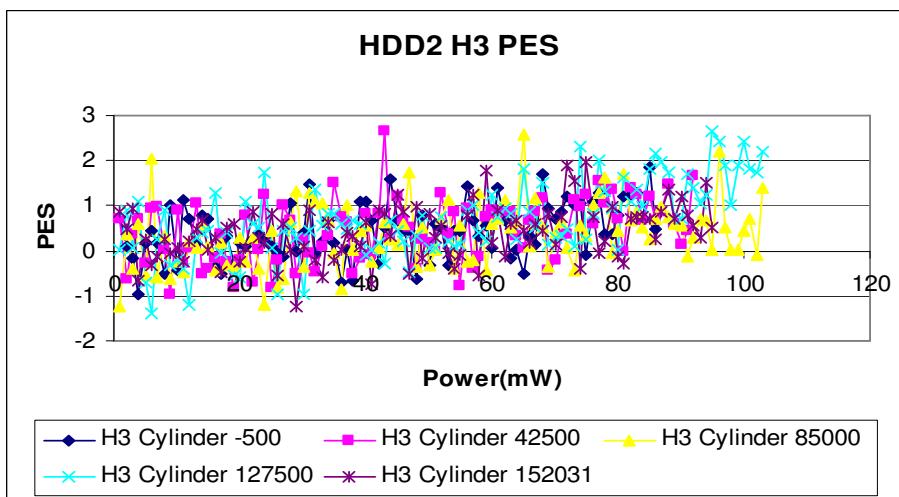
ภาพประกอบ 3-20 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



ภาพประกอบ 3-21 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



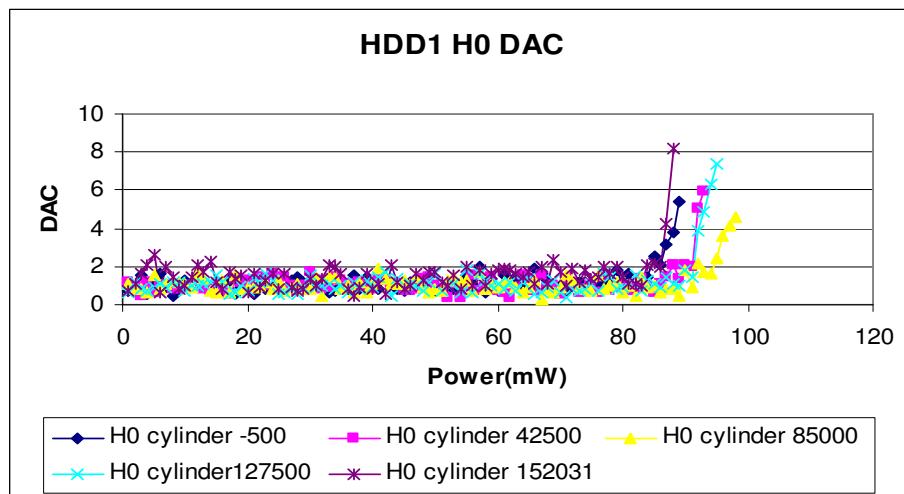
ภาพประกอบ 3-22 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



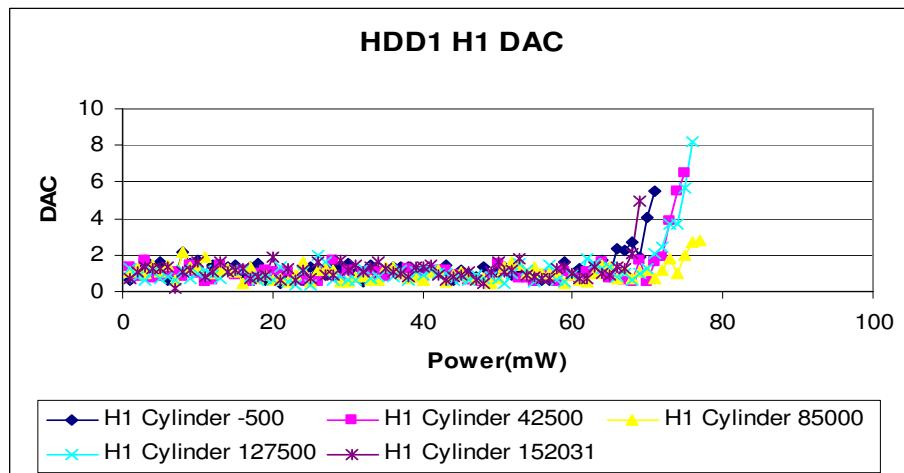
ภาพประกอบ 3-23 ค่าเฉลี่ย PES ของ HDD2 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน

### 3.5.2 ผลการทดสอบ DAC

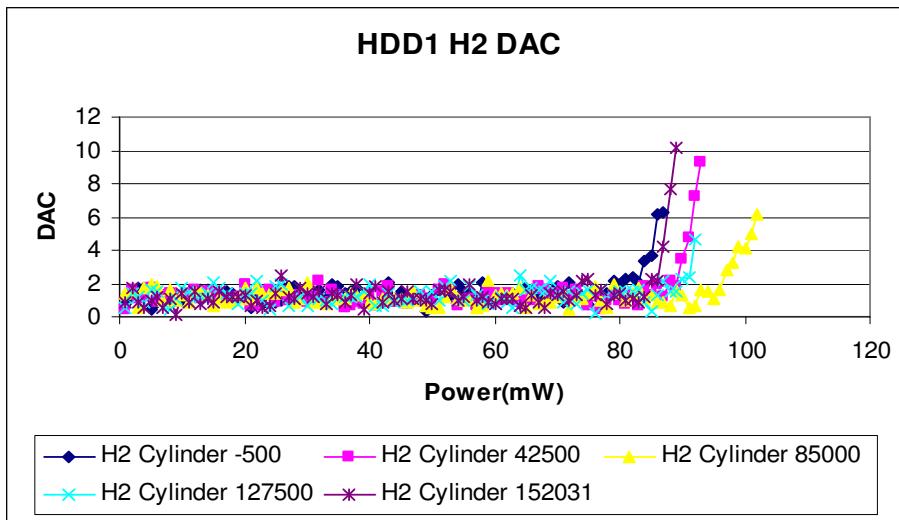
ผลการทดสอบ DAC ซึ่งก็คือค่า digital to analog converter ที่ใช้สำหรับการควบคุม voice coil motor เพื่อให้หัวอ่าน-เขียนอยู่กึ่งกลางของแทร็คโดยใช้ค่าของ PES เป็นตัวระบุตำแหน่งของหัวอ่าน-เขียนซึ่งได้ผลการการทดสอบดังภาพประกอบ 3-24 - 3-31



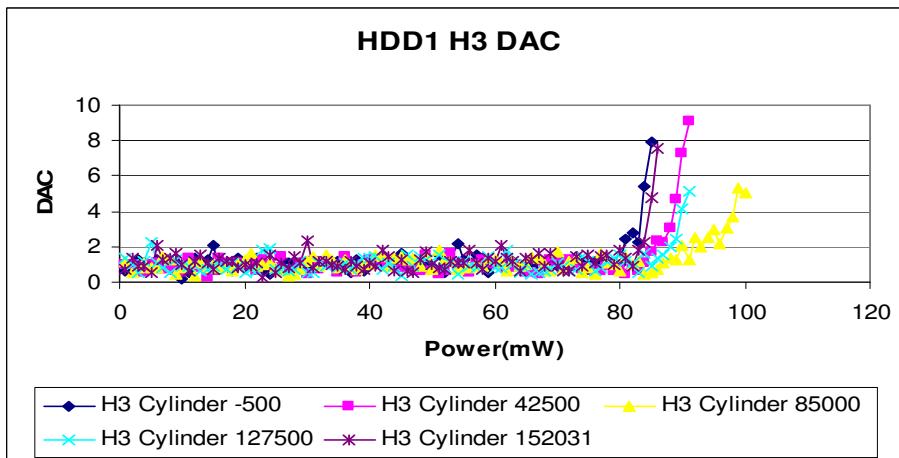
ภาพประกอบ 3-24 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



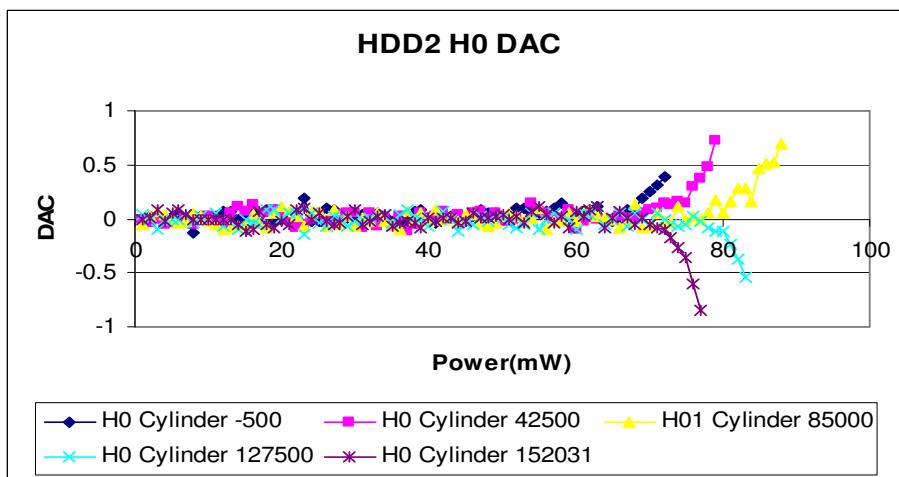
ภาพประกอบ 3-25 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



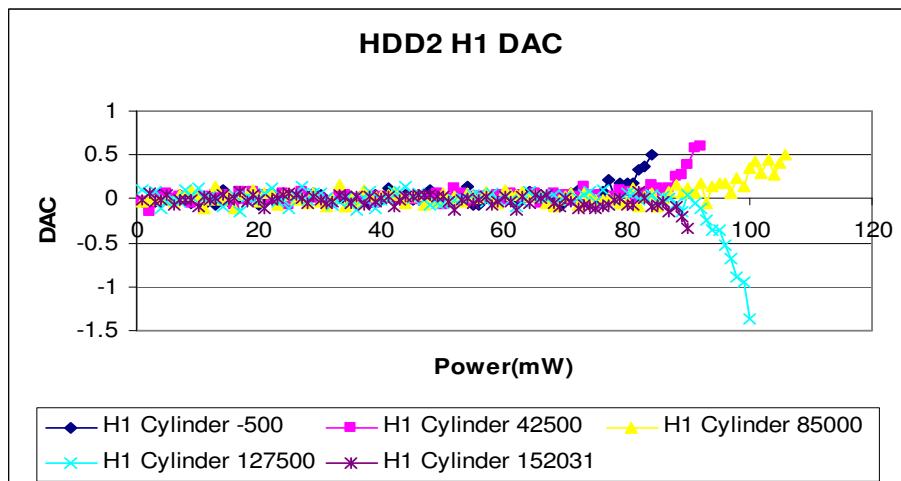
ภาพประกอบ 3-26 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



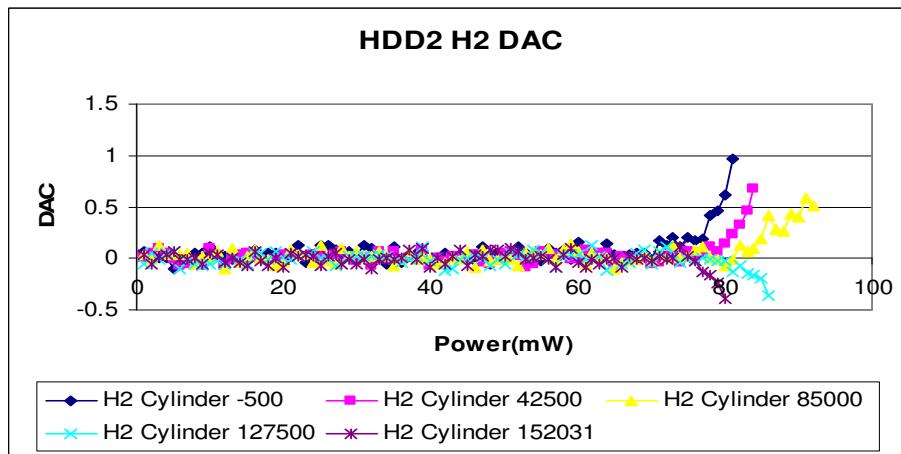
ภาพประกอบ 3-27 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD1 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



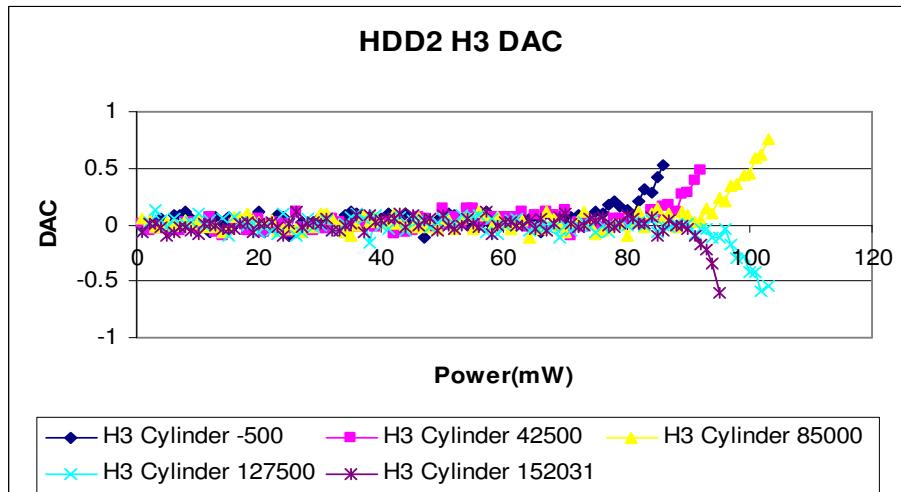
ภาพประกอบ 3-28 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H0 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



ภาพประกอบ 3-29 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H1 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



ภาพประกอบ 3-30 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H2 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน



ภาพประกอบ 3-31 ค่าเฉลี่ย DAC ของ HDD2 H3 เมื่อ FH เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการให้ความร้อน

ผลจากการทดสอบค่า PES และค่า DAC ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของหัวอ่าน-เขียนในการรักษาตำแหน่งหรือระบุตำแหน่ง โดยการทดสอบแสดงผลการทดสอบค่า PES ดังภาพประกอบ 3-16 ถึง 3-23 และผลการทดสอบค่า DAC ดังภาพประกอบ 3-24 ถึง 3-31 ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าเมื่อหัวอ่าน-เขียนถูกให้ความร้อนจากเทคโนโลยี thermal fly-height control จนหัวอ่าน-เขียนขยายตัวทำให้ระยะ FH น้อยลงจนกระทั่งเข้าใกล้คิสก์ การเปลี่ยนแปลงของค่า PES และ DAC จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเบียงเบนจากค่ากลาง แต่จากการทดสอบจากหัวอ่าน-เขียนดังภาพประกอบ 3-24 ถึง 3-31 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า DAC จะมีค่าการเปลี่ยนแปลงที่ให้ได้ชัดเจนมากกว่าค่า PES และจากผลการทดลองทั้งหมดของค่า DAC นั้นผลการทดลองที่ได้ค่าการเปลี่ยนแปลงของทุกหัวอ่าน-เขียนมีการเปลี่ยนแปลงค่า DAC อย่างเห็นได้ชัดเจนทุกตัวหรือ 100% นั่นเอง

### 3.6 การทดสอบ SER

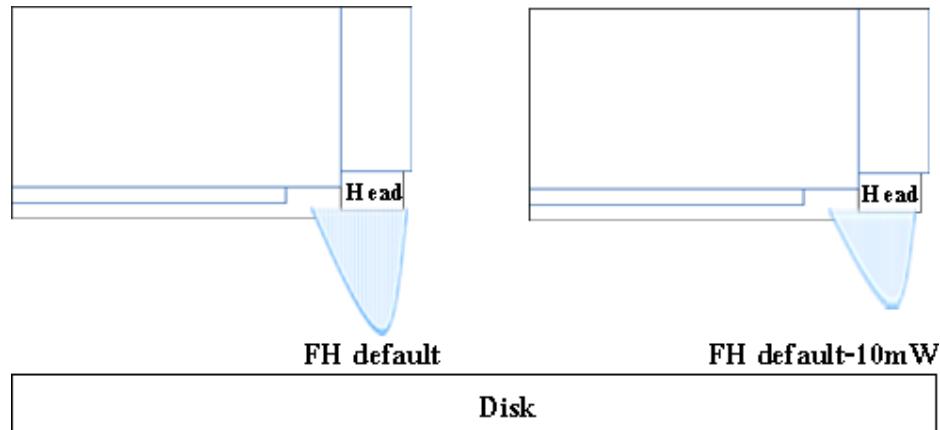
SER เป็นค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการอ่านและการเขียนข้อมูล โดยเมื่อเขียนข้อมูลลงแผ่นคิสก์และอ่านข้อมูลกลับมาเมื่อโอกาสของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในกระบวนการเขียนหรืออ่าน โดยตามหลักการทำงานทั่วไปแล้วหากระยะของ FH อยู่ในระดับสูงค่า SER ที่ได้ย่อมมีค่ามากกว่าค่า SER ของ FH ที่มีระดับต่ำเข้าใกล้คิสก์ เพราะเมื่อหัวอ่าน-เขียนอยู่ในระดับต่ำแล้ว signal to noise ratio ย่อมดีกว่าเมื่อหัวอ่าน-เขียนอยู่สูง ดังนั้นการทดสอบครั้งนี้เพื่อคุ้มครองความสัมพันธ์ของ SER ที่มีต่อระยะ FH ตามหลักการเบื้องต้นหรือไม่

#### 3.6.1 วิธีการทดสอบ

- กำหนดจุดทดสอบที่ทุกโซนของอาร์คคิสก์ไดร์ฟโดยาร์คคิสก์ไดร์ฟที่ทดสอบนั้นถูกแบ่งโซนไว้ทั้งหมด 24 โซนเริ่มต้นตั้งแต่โซน 0-23 ซึ่งโซน 0 อยู่ที่วงนอกสุดของคิสก์และโซน 24 อยู่ในสุดของคิสก์

- การกำหนดระยะ FH จะกำหนดค่าการทดสอบครั้งแรกเป็นค่าที่โรงงานกำหนดไว้ หลังจากนั้นจึงลด FH ลงครั้งละ 10mW ทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งจะได้ค่า FH เป็นดังนี้ FH(default), FH(default)-10mW, FH(default)-20mW, FH(default)-30mW ดังภาพประกอบ 3-32

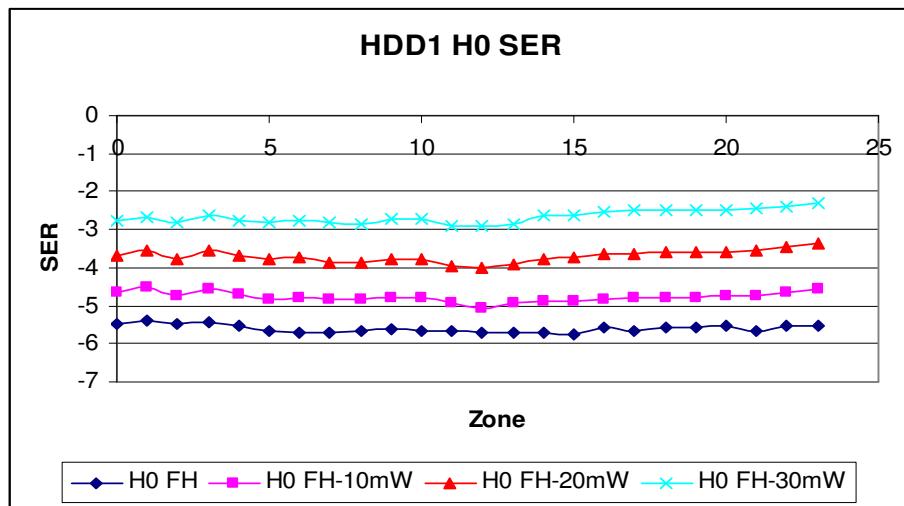
- ผลของการบันทึกค่าจะถูกเก็บไว้ใน log file เพื่อนำมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น



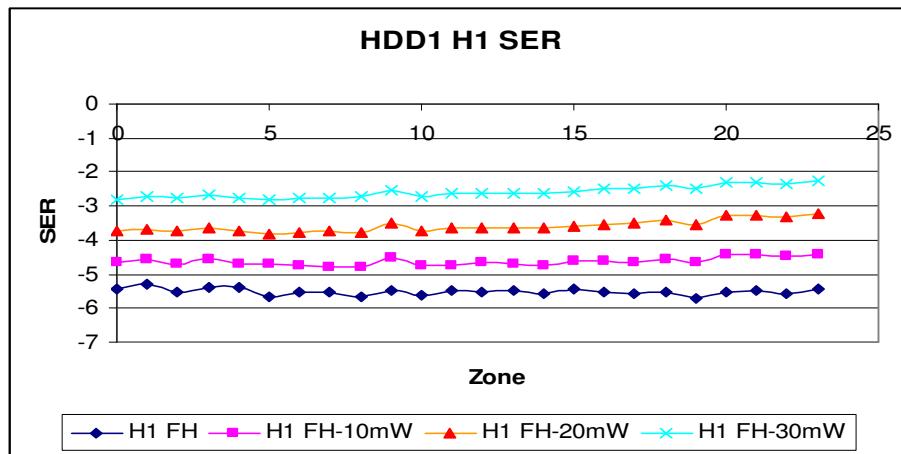
ภาพประกอบ 3-32 การลดระยะ FH ด้วยการลดกำลังงานที่ให้แก่หัวอ่าน-เขียน

### 3.6.2 ผลการทดสอบ SER

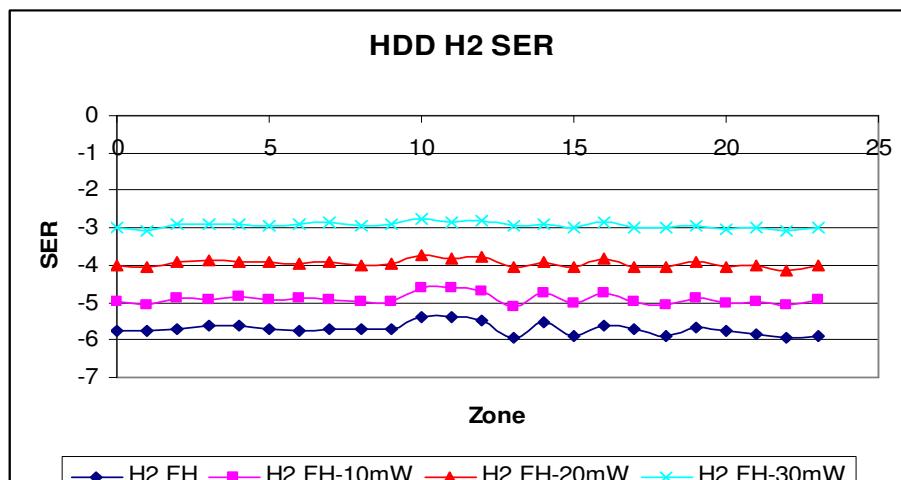
ผลการทดสอบ SER ในแต่ละโซนของฮาร์ดดิสก์ไครอฟแฟรงค์ดังภาพประกอบ 3-31 ถึง 3-37 โดยภาพประกอบ 3-33 ถึงภาพประกอบ 3-36 แสดงผลในส่วนของค่า SER ทุกโซน ของดิสก์ในแต่ระดับของระยะ FH ส่วนภาพประกอบ 3-37 ถึง 3-39 เป็นการแสดงรายละเอียดใน บางโซนของดิสก์เพื่อสามารถดูผลการทดสอบได้ละเอียดยิ่งขึ้น



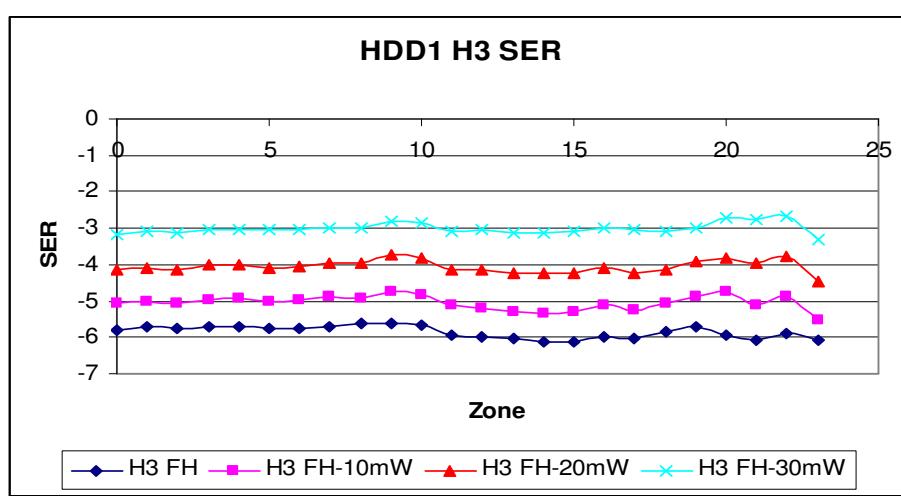
ภาพประกอบ 3-33 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H0



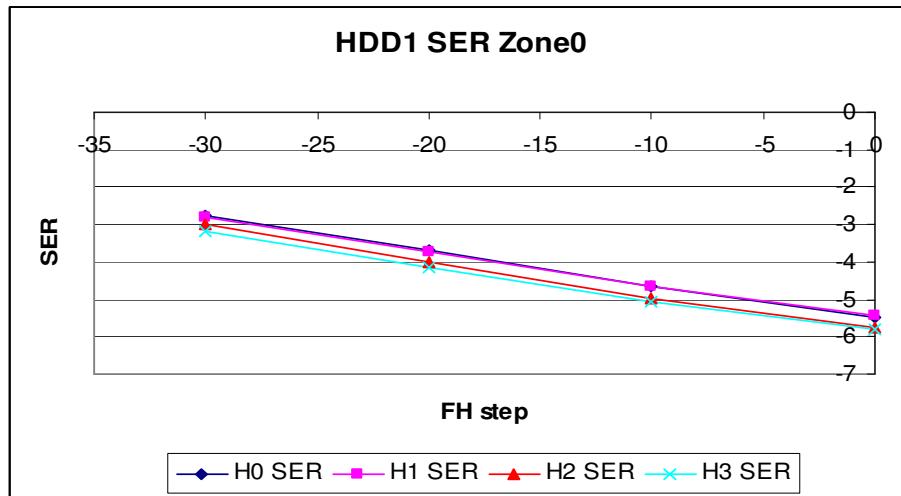
ภาพประกอบ 3-34 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H1



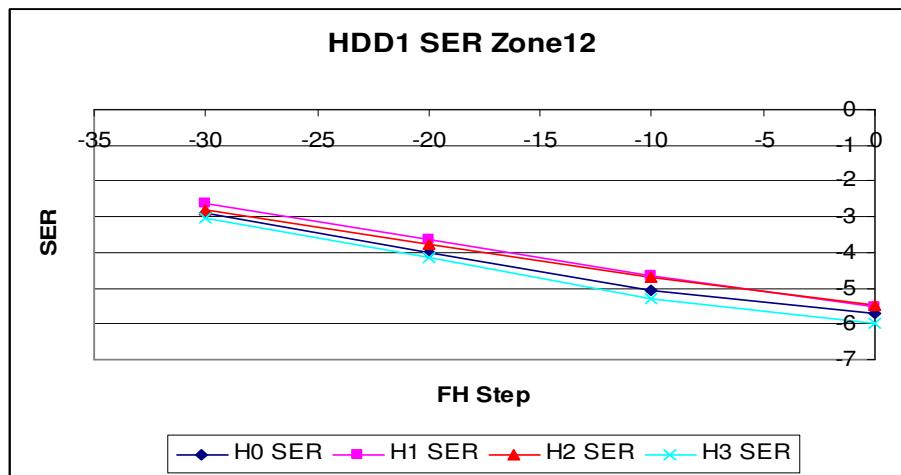
ภาพประกอบ 3-35 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H2



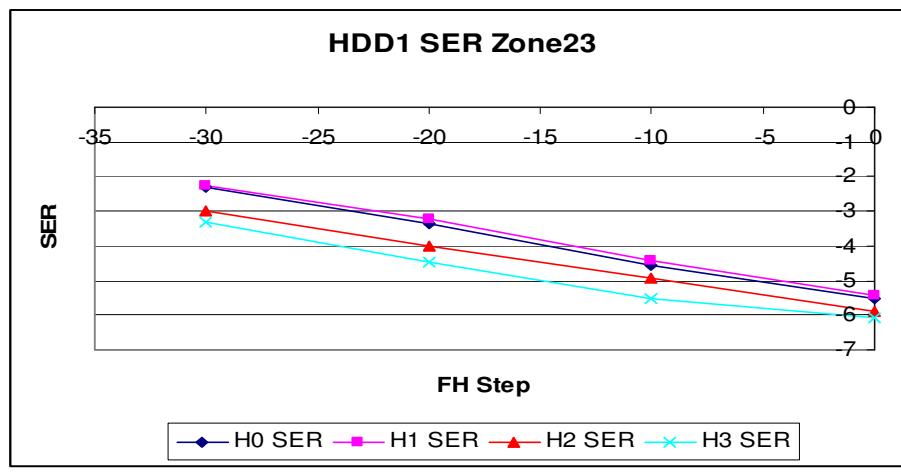
ภาพประกอบ 3-36 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ H3



ภาพประกอบ 3-37 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ Zone0



ภาพประกอบ 3-38 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ Zone12



ภาพประกอบ 3-39 ผลการเพิ่มระยะ FH ที่ Zone23

ผลการทดสอบ SER เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนของระยะ FH ต่อค่า SER แสดงให้เห็นจากการทดสอบว่าระยะ FH จะส่งผลต่อค่า SER อย่างเห็นได้ชัดเจนในทุกโซนของคิสก์โดยเมื่อเพิ่มความสูงของระยะ FH ซึ่งก็คือทำให้ระยะระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับคิสก์เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า SER แย่ลงเนื่องจากเมื่อหัวอ่าน-เขียนอยู่ห่างจากคิสก์เรื่อยๆ จะให้ signal to noise ratio ต่ำซึ่งคงจะส่งผลต่อค่า SER เนื่องจากเมื่อ signal to noise ratio ต่ำจะทำให้การอ่านเขียนข้อมูลมีโอกาสผิดพลาดสูง

เมื่อพิจารณาภาพประกอบ 3-37 ถึง 3-39 ซึ่งเป็นภาพประกอบที่แสดงรายละเอียดของค่า SER ในโซน 0, 12, และ 23 เห็นความสัมพันธ์ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า SER ในแต่ละโซนเป็นไปในแนวเดินเดินในทุกโซนและทุกหัวอ่าน-เขียนที่ใช้ทดสอบดังนั้นหากระยะระหว่างหัวอ่าน-เขียนกับคิสก์ใกล้กันมากเท่าไหร่ย่อมส่งผลดีต่อค่า SER เพิ่มขึ้นด้วย

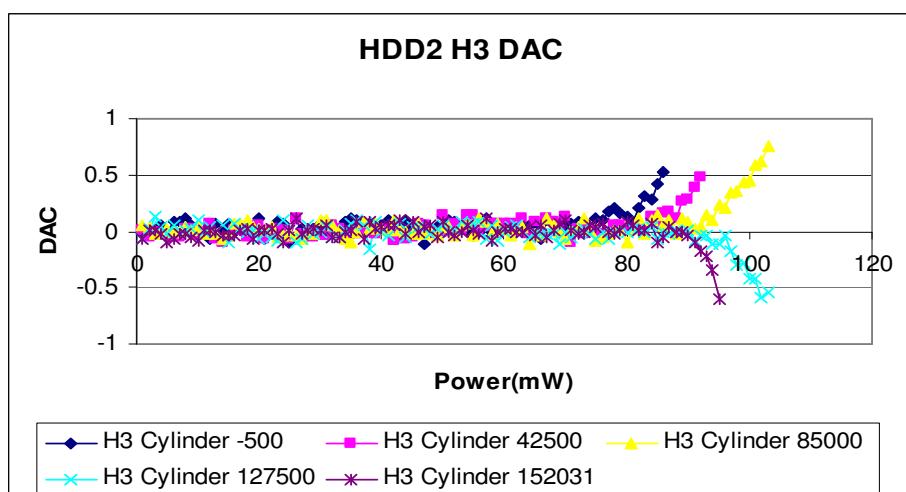
## บทที่ 4

### การออกแบบระบบเบียนวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาด จากการอ่าน-เขียนข้อมูล

หลักจากที่ได้ศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์เกี่ยวกับพารามิเตอร์ภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวนี้องกับระบบการบินของหัวอ่าน-เขียนทำให้ได้ข้อมูลความสัมพันธ์มาเป็นแนวทางในการออกแบบอัลกอริทึมเพื่อให้ได้ระบบที่ดีที่เหมาะสมต่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

#### 4.1 ความเกี่ยวเนื่องของตัวแปรภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

จากการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและการควบคุมหัวอ่าน-เขียนในบทที่ 3 ตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของหัวอ่าน-เขียนเมื่อเข้าใกล้ดิสก์อย่างเห็นได้ชัดเจนคือค่า DAC เห็นได้จากค่า DAC จะเคลื่อนที่ออกจากค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้านบนและด้านลับและในอีกรูปหนึ่งคือค่าสูงสุด (peak) ของ DAC จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้ดิสก์ เช่น กันดังตัวอย่างภาพประกอบ 4-1 ที่เป็นค่าพารามิเตอร์ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่สองหัวที่สามที่ใช้ทดสอบ

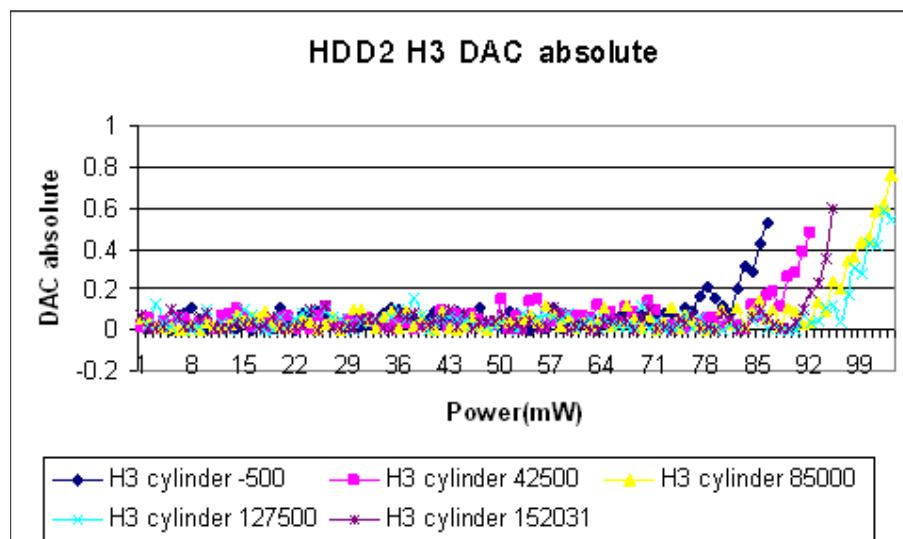


ภาพประกอบ 4-1 ตัวอย่างค่า DAC ของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่ 2 หัวที่ 3

#### 4.2 ข้อพิจารณาการเลือกใช้พารามิเตอร์

จากผลการทดสอบในบทที่สามซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าค่า DAC มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่าค่า PES ดังนั้นจึงเลือกใช้ค่า DAC เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบอัลกอริทึม

จากการเปลี่ยนแปลงของค่า DAC จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านค่าบวกและด้านลบแสดงดังภาพประกอบที่ 4-1 ดังนั้นเพื่อสะท้อนในการคำนวณและเพื่อความยืดหยุ่นของอัลกอริทึมนั้นจึงนำค่า DAC มาหาค่าสัมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ค่า DAC ที่ได้หลังจากการคำนวณจะเกลี่ือนที่อยู่ในด้านบวกเสมอดังภาพประกอบ 4-2 ที่แสดงค่าจากการคำนวณมาจากของชาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่สองหัวที่สาม



ภาพประกอบ 4-2 ด้าวย่างค่าสัมบูรณ์ของ DAC ของชาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่ 2 หัวที่ 3

#### 4.3 ข้อพิจารณาการตรวจจับความผิดปกติของค่า DAC

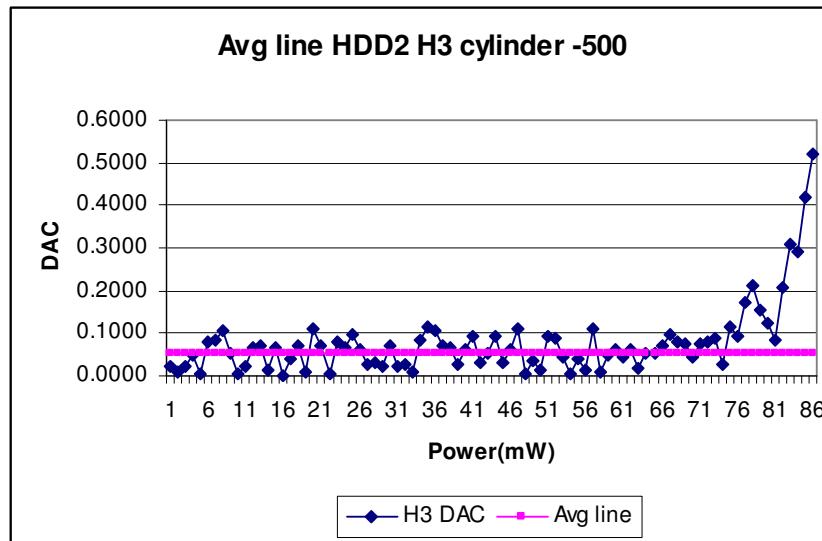
การตรวจจับค่าผิดปกติของ DAC เพื่อจะเป็นตัวบ่งบอกพฤติกรรมที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของหัวอ่าน-เขียนเมื่อเริ่มเข้าใกล้ดิสก์หรือกีกี FH ต่ำๆ มากจนนั่นเอง ซึ่งการพิจารณาผลนำมาจากการทดสอบจากบทที่ 3 การตรวจจับค่าความผิดปกติของ DAC นั้นจะดูการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างค่าสูงสุดของการวัด โดยค่าสูงสุดถูกร่วมมาจากการให้กำลังงานความร้อนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึง 40mW เพื่อหาค่าสูงสุด

#### 4.4 การคำนวณเส้นค่าเฉลี่ย (Avg line)

เนื่องจากค่า DAC สูงสุดได้รับรวมมาจาก การให้กำลังงานความร้อนจนกระทั้งถึง การให้กำลังงานความร้อนที่ 40mW ดังนั้นค่าทึ้งหมดที่วัดได้จะถูกนำมาคำนวณโดยการหาผลบวก ของค่า DAC ทึ้งหมดหารด้วยจำนวนครั้งของการวัดดังสมการ (4.1) จึงได้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่ง ตัวอย่างค่าเฉลี่ยแสดงดังภาพประกอบ 4-3 โดยใช้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่สองหัวที่สาม ตำแหน่ง cylinder ที่ -500

$$Avg_{line} = \frac{\sum_{n=1}^k DAC_n}{k} \quad (4.1)$$

*k* คือจำนวนครั้งของการวัด

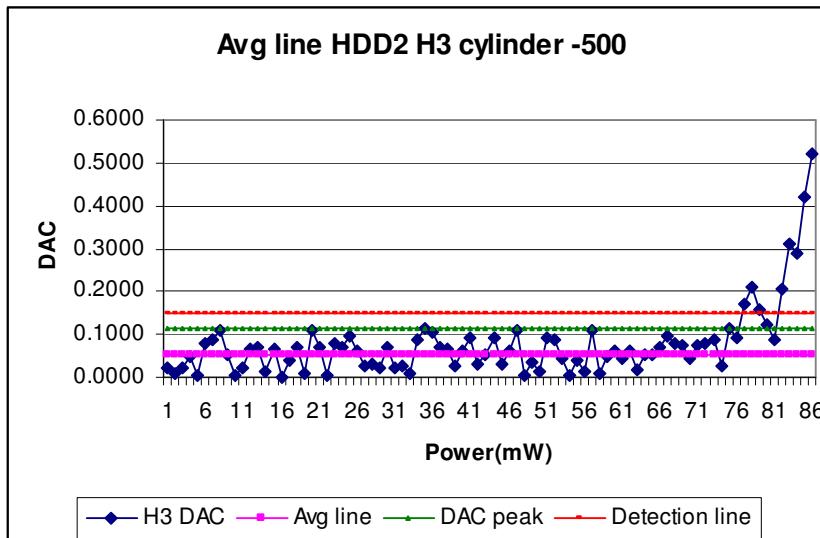


ภาพประกอบ 4-3 เส้นตัวอย่างค่าเฉลี่ยของ H3

#### 4.5 การคำนวณเส้นตรวจจับความผิดปกติ (Detection line)

เส้นตรวจจับความผิดปกติของค่า DAC ใช้เพื่อกำหนดความผิดปกติของค่า DAC ที่จะเกิดขึ้นเมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้สัก โดยคำนวณจากการหาค่าสูงสุดของค่า DAC จากการเก็บ ตัวอย่างที่ได้มาจากการเริ่มให้ความร้อนจนกระทั้งกำลังงานที่ให้เป็น 40mW เพื่อใช้ในสมการ (4.2) โดย 1.5 คือค่า error ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่า DAC สูงสุด

$$Dtectionline = ((DAC_{peak} - Avg_{line}) \times 1.5) + Avg_{line} \quad (4.2)$$



ภาพประกอบ 4-4 เส้นตัวอย่าง DAC peak, Avg line, Detection line และเส้นค่าเฉลี่ยของ H3

#### 4.6 เทคนิคการแยกค่า DAC เพื่อใช้คำนวณ

เนื่องจากค่า DAC ที่ใช้ในการคำนวณเป็นค่าที่ได้มาจากการอ่านข้อมูลดังนั้น ความไม่แน่นอนของการตรวจจับการเข้าใกล้สักของหัวอ่าน-เขียนย่อمنอย่างตามจำนวนของการนำมายา ค่าเฉลี่ยดังนี้จึงใช้วิธีการนำค่า DAC มาตรวจจับความผิดปกติดังนี้

1. กำหนด window size สำหรับการแยกค่า DAC เพื่อนำมาวิเคราะห์
2. ข้อมูลที่นำเข้ามาใน window size ใช้วิธี FIFO คือข้อมูลที่เข้ามาก่อนจะถูกนำมา วิเคราะห์ก่อนดังภาพประกอบ 4-5
3. ข้อมูลเมื่อมาอยู่ใน window แล้วจะถูกเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อย

ภาพประกอบ 4-6

4. จากนั้นเอาข้อมูลมาแบ่งกลุ่มสูงสุด ต่ำสุด และกึ่งกลางดังภาพประกอบ 4-7 มา คำนวณหาค่าสัมบูรณ์เพื่อนำมาคำนวณ DAC peak, avg line, detection line
5. เมื่อค่าได้มาหนึ่งในกลุ่มที่ถูกแยกออกมากแล้วเคลื่อนที่หนึ่นไปสืบต่อ detection line จะเป็นการระบุว่าหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้สักมากเกินไป

| ข้อมูล FIFO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| DAC         | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 3  |
| Window1     | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 3  |
| Window2     | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 3  |
| Window3     | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 3  |
| Window4     | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 3  |

ภาพประกอบ 4-5 ข้อมูลที่นำเข้ามาใน window size กำหนดความกว้างไว้ที่ 5

|         |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| Window1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Window2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Window3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Window4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

ภาพประกอบ 4-6 ข้อมูลที่นำเข้ามาใน window size เรียงข้อมูลจากมากไปน้อย

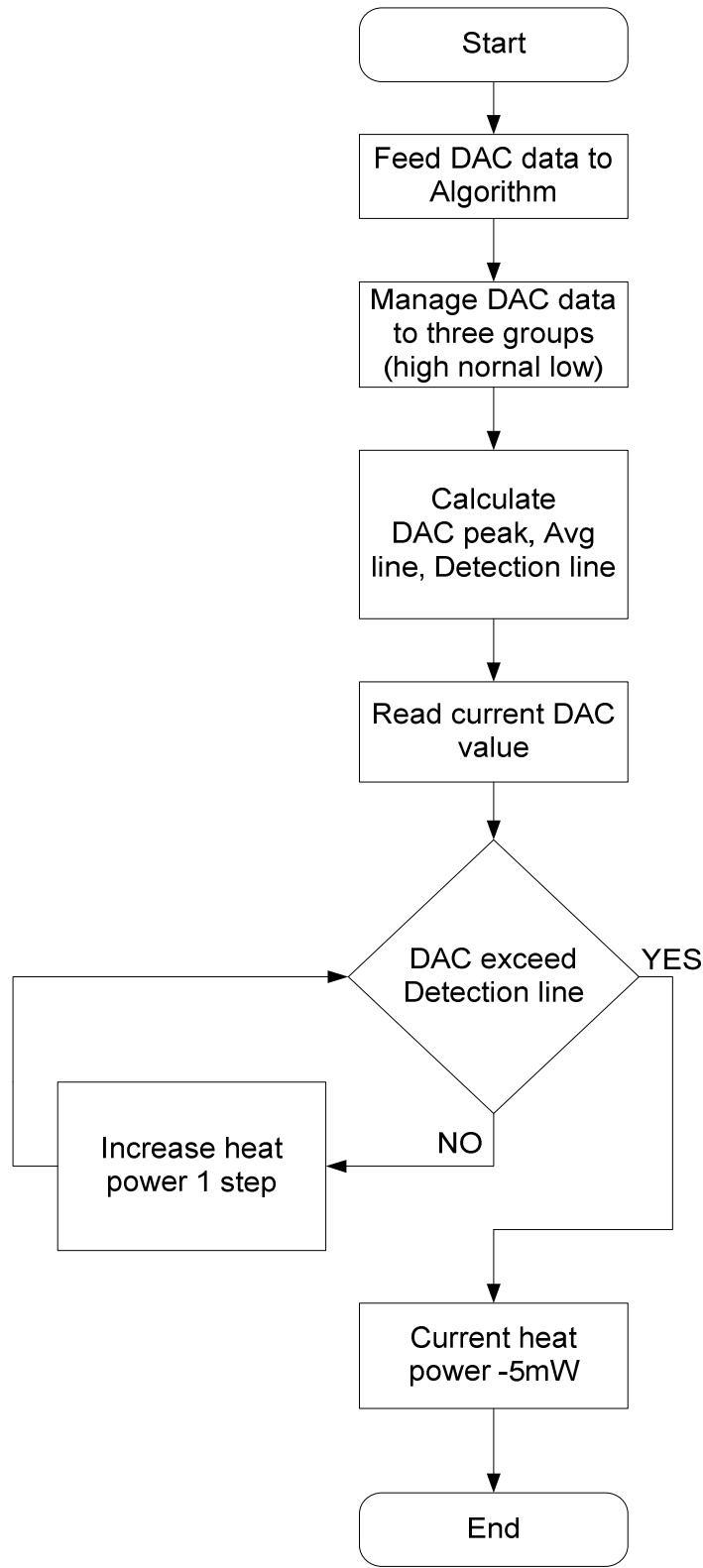
|         |   |   |   |   |   |             |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
| Window1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Window2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Window3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Window4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | เรียงข้อมูล | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

|            |   |   |   |   |     |   |
|------------|---|---|---|---|-----|---|
| Windows    | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | k |
| DAC high   | 5 | 5 | 5 | 5 | ... | k |
| DAC normal | 3 | 3 | 3 | 3 | ... | k |
| DAC low    | 2 | 2 | 2 | 1 | ... | k |

ภาพประกอบ 4-7 ข้อมูลใน windows ที่ถูกแบ่งแยกกลุ่มเพื่อนำไปคำนวณ

#### 4.7 สรุปการออกแบบระบบเบียนวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เบียนสาร์ดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เบียนข้อมูล

ขั้นตอนการทำงานของระบบเบียนวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เบียนสาร์ดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เบียนข้อมูลจากการอ่าน-เบียนข้อมูลสามารถอธิบายได้ดังภาพประกอบ 4-8 เริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลค่า DAC ให้แก่อัลกอริทึมเพื่อนำข้อมูลมาแบ่งเป็นกลุ่มของค่าสูงสุด กึ่งกลาง และต่ำสุด มาหาค่าสัมบูรณ์เพื่อนำมาคำนวณ DAC peak, avg line, detection line ของแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการแบ่งเป็น windows ดังที่ได้อธิบายในหัวข้อ 4.6 หลังจากได้ค่าต่างๆแล้วขั้นตอนต่อไปคือให้ความร้อนไปที่หัวอ่านจนกระทั่งมีการแจ้งเตือนการตรวจค่าผิดปกติของค่า DAC เนื่องจากเกลื่อนที่เหนือเส้น detection line เมื่อมีการแจ้งเตือนแสดงว่าหัวอ่าน-เบียนเข้าใกล้ดิสก์มากเกินไปจึงต้องมีการลดกำลังงานที่ส่งให้หัวอ่าน-เบียนโดยกำหนดให้ลดกำลังงานจากจุดที่ตรวจพบเป็น -5mW เพื่อไม่ให้อัลกอริทึมแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาจึงได้เป็นค่าที่เหมาะสมกับสาร์ดิสก์ในแต่ละโซน



ภาพประกอบ 4-8 Flow chart ของอัลกอริทึมการกำหนดระดับ FH

#### 4.8 การทดสอบอัลกอริทึมกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจริง

หลังจากได้ออกแบบอัลกอริทึมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จึงเป็นการนำอัลกอริทึมที่ได้ออกแบบมาใช้กับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจริงโดยทดสอบกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตัวที่หนึ่งที่หัว 0 และ 3 ซึ่งได้ผลการทดสอบเป็นดังนี้

ตารางที่ 4-1 สรุปค่า SER และ FH ของ H0 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากโรงงาน

| Cylinder | Default    | SER H0 |        |        |        |         |          |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
|          | test cycle |        |        |        |        | Avg     | FH Power |
|          | 1          | 2      | 3      | 4      | 5      |         |          |
| 0        | -5.648     | -5.223 | -5.589 | -5.512 | -5.482 | -5.4908 | 73       |
| 42500    | -6.067     | -6.334 | -6.055 | -5.903 | -5.864 | -6.0446 | 72       |
| 85000    | -5.976     | -6.226 | -5.818 | -5.872 | -6.453 | -6.0690 | 71       |
| 127500   | -5.571     | -5.755 | -5.658 | -5.568 | -5.733 | -5.6570 | 69       |
| 153021   | -5.581     | -5.374 | -5.317 | -5.644 | -5.570 | -5.4972 | 69       |

ตารางที่ 4-2 สรุปค่า SER และ FH ของ H0 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากอัลกอริทึม

| Cylinder | Algorithm  | SER H0 |        |        |        |         |          |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
|          | test cycle |        |        |        |        | Avg     | FH Power |
|          | 1          | 2      | 3      | 4      | 5      |         |          |
| 0        | -5.798     | -5.582 | -5.737 | -5.753 | -5.792 | -5.7324 | 78       |
| 42500    | -7.033     | -6.594 | -6.459 | -6.635 | -6.431 | -6.6304 | 84       |
| 85000    | -6.427     | -6.402 | -6.481 | -6.379 | -6.356 | -6.4090 | 89       |
| 127500   | -6.812     | -5.894 | -6.21  | -6.335 | -5.586 | -6.1674 | 85       |
| 153021   | -6.539     | -6.073 | -5.784 | -6.051 | -7.176 | -6.3246 | 80       |

ตารางที่ 4-3 สรุปค่า SER และ FH ของ H3 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากโรงงาน

| Cylinder | Default    | SER H3 |        |        |        |         |          |
|----------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
|          | test cycle |        |        |        |        | Avg     | FH Power |
|          | 1          | 2      | 3      | 4      | 5      |         |          |
| 0        | -6.055     | -5.985 | -5.600 | -5.794 | -5.994 | -5.8856 | 68       |
| 42500    | -6.117     | -5.754 | -6.459 | -6.255 | -6.117 | -6.1404 | 67       |
| 85000    | -6.038     | -5.883 | -6.105 | -6.281 | -6.360 | -6.1334 | 67       |
| 127500   | -6.857     | -7.158 | -6.857 | -7.158 | -7.033 | -7.0126 | 67       |
| 153021   | -6.36      | -6.281 | -5.717 | -6.008 | -6.059 | -6.0850 | 67       |

ตารางที่ 4-4 สรุปค่า SER และ FH ของ H3 ที่ได้จากการทดสอบค่าจากอัลกอริทึม

| Cylinder | Algorithm | SER H3 | Avg    | FH Power |        |         |    |
|----------|-----------|--------|--------|----------|--------|---------|----|
|          | 1         | 2      | 3      | 4        | 5      |         |    |
| 0        | -6.152    | -6.453 | -6.277 | -6.511   | -6.335 | -6.3456 | 75 |
| 42500    | -6.681    | -6.521 | -6.104 | -6.130   | -6.431 | -6.3734 | 79 |
| 85000    | -6.184    | -6.263 | -6.360 | -7.059   | -6.883 | -6.5498 | 85 |
| 127500   | -7.334    | -7.635 | -7.334 | -6.936   | -7.033 | -7.2544 | 81 |
| 153021   | -6.170    | -6.105 | -7.059 | -6.199   | -6.184 | -6.3434 | 77 |

ตารางที่ 4-5 สรุปค่า SER และ FH ของ H0 ที่ได้จากการทดสอบของโรงงานกับอัลกอริทึม

| Cylinder | SER Avg |           |         |          | FH Power |           |       |
|----------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-------|
|          | Default | Algorithm | Delta   | %Improve | Default  | Algorithm | Delta |
| 0        | -5.4908 | -5.7324   | -0.2416 | 4.400    | 73       | 78        | 5     |
| 42500    | -6.0446 | -6.6304   | -0.5858 | 9.691    | 72       | 84        | 12    |
| 85000    | -6.0690 | -6.4090   | -0.3400 | 5.602    | 71       | 89        | 18    |
| 127500   | -5.6570 | -6.1674   | -0.5104 | 9.022    | 69       | 85        | 16    |
| 153021   | -5.4972 | -6.3246   | -0.8274 | 15.051   | 69       | 80        | 11    |

ตารางที่ 4-6 สรุปค่า SER และ FH ของ H3 ที่ได้จากการทดสอบของโรงงานกับอัลกอริทึม

| Cylinder | SER Avg |           |         |          | FH Power |           |       |
|----------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|-------|
|          | Default | Algorithm | Delta   | %Improve | Default  | Algorithm | Delta |
| 0        | -5.8856 | -6.346    | -0.4600 | 7.816    | 68       | 75        | 7     |
| 42500    | -6.1404 | -6.373    | -0.2330 | 3.795    | 67       | 79        | 12    |
| 85000    | -6.1334 | -6.550    | -0.4164 | 6.789    | 67       | 85        | 18    |
| 127500   | -7.0126 | -7.254    | -0.2418 | 3.448    | 67       | 81        | 14    |
| 153021   | -6.0850 | -6.343    | -0.2584 | 4.247    | 67       | 77        | 10    |

#### 4.9 การวิจารณ์ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบการทดสอบอัลกอริทึมที่ใช้ในการตรวจจับการเข้าใกล้ของหัวอ่าน-เขียนหาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ผลจากการทดสอบสามารถตรวจจับการเข้าใกล้ดีสก์ได้เมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้ดีสก์

ผลการกำหนดระยะเวลา FH ด้วยอัลกอริทึมในแต่ละตำแหน่งของหาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นที่น่าพอใจว่าสามารถปรับปรุง SER ให้ดีขึ้นกว่าการตั้งค่า FH มาจากโรงงาน ผลของ SER ที่ดีขึ้นเป็นผลจาก FH ที่ตั้งลงทำให้สามารถเพิ่ม signal to noise ratio ได้ดีขึ้นทำให้ความผิดพลาดจากการเขียนหรืออ่านข้อมูลจากหัวอ่าน-เขียนลดลงส่งผลให้ SER ดีขึ้นเหลือ 6.99%

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

หลังจากที่ได้ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาตำแหน่งและการควบคุมหัวอ่าน-เขียนให้อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางแทรร์ค จากนั้นจึงทดสอบดูผลการควบคุมระยะ FH เมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้สักแล้วนำผลการทดสอบนั้นมาออกแบบเป็นอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุง SER ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงบทสรุปของงานวิจัยในการออกแบบและการทดสอบอัลกอริทึม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้

#### 5.1 สรุปผล

จากการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตำแหน่งของหัวอ่าน-เขียน จากนั้นจึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้สักโดยมีการทดสอบค่า PES และ DAC ซึ่งจากผลการทดสอบเห็นได้ชัดเจนว่าค่า DAC มีการเคลื่อนไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเข้าใกล้สัก

ตัวแปรที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการเคลื่อนที่ของหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้สักนั้นคือค่า DAC จึงนำตัวแปรนี้ไปใช้ในอัลกอริทึมเพื่อตรวจจับหัวอ่าน-เขียนเริ่มเคลื่อนเข้าใกล้สักเพื่อป้องกันการชนของอาร์คิดสักไดร์ฟ ผลการทดสอบปรากฏว่าสามารถตรวจจับหัวอ่าน-เขียนได้ก่อนการชนกันของหัวอ่าน-เขียนกับดิสก์โดยเทียบเคียงจากกำลังงานงานที่สุดจากการตรวจจับด้วยเทคโนโลยี TFC

ค่ากำลังงานที่ใช้กำหนดระยะ FH เป็นกำลังงานที่ได้จากการใช้อัลกอริทึมซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่าการตรวจจับเมื่อหัวอ่าน-เขียนเข้าใกล้สัก ดังนั้นเมื่อใช้กำลังงานที่ได้นี้กำหนดระยะ FH เป็นการยกที่จะทำให้หัวอ่าน-เขียนชนกับดิสก์เนื่องจากเมื่อหัวอ่าน-เขียนเคลื่อนที่เข้าใกล้สักสามารถตรวจพบด้วยอัลกอริทึมนี้ ซึ่งหากมีการตรวจพบรการเข้าใกล้สักของหัวอ่าน-เขียนเกิดขึ้นสามารถลดระยะ FH เพื่อป้องกันการชนของหัวอ่าน-เขียน

ความผิดพลาดของการอ่านเขียนข้อมูลกฎวัดด้วยค่า SER ซึ่งจากการทดสอบในบทที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะ FH ลดลงจะส่งผลดีต่อค่า SER มากยิ่งขึ้น และจากผลของการออกแบบอัลกอริทึมทำให้ได้ค่ากำหนด FH ที่ส่งผลให้ FH เข้าใกล้สักมากกว่าค่าที่กำหนดจากโรงงาน ดังนั้นผลของค่า SER ที่ได้จึงดีกว่า SER จากโรงงานซึ่งเป็นไปสอดคล้องตามผลการทดสอบจากบทที่ 3

## 5.2 ปัญหา

5.2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ FH ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการวัดระยะ FH ซึ่งเป็นการวัดด้วยเลเซอร์ทั่วไปในงานวิจัยนี้ไม่สามารถตรวจได้เนื่องจากติดปัญหาความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดจึงใช้เทคโนโลยี TFC เพื่อหาระยะ FH

5.2.2 ข้อจำกัดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ใช้ทดสอบเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องจำนวนที่ใช้ทดสอบในงานวิจัย

5.2.3 การค้นคว้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ใช้ทดสอบเป็นไปได้ก่อนข้างลำบากเนื่องจากเป็นความลับของผู้ผลิตที่ไม่สามารถเผยแพร่และให้ความรู้แก่ผู้วิจัยได้

5.2.4 การค้นคว้าข้อมูลความรู้จากสิทธิบัตรต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทดสอบเนื่องจากสิทธิบัตรที่สามารถค้นคว้าได้ก่อนข้างเก่า

## 5.3 ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยนี้เป็นการลดระยะ FH ของหัวอ่าน-เขียนโดยสามารถลดระยะ FH ได้ต่ำกว่าค่าจากโรงงานกำหนดทำให้ SER ดีขึ้น ซึ่งในอนาคตความจุของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจะมีความจุเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน และการที่จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟมีความจุเพิ่มสูงขึ้นนั้นก็จำเป็นต้องทำให้พื้นที่หน่วยความจุเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะทำให้จุดของการเขียนอ่านข้อมูลถูกกลบทำให้สัญญาณที่อ่านได้มีปริมาณต่ำอาจทำให้ signal to noise ratio น้อยลงไปด้วยดังนั้นถ้าหากทำให้หัวอ่าน-เขียนอยู่ใกล้ดิสก์มากขึ้นด้วยการใช้อัลกอริทึมนี้เป็นการช่วยให้ signal to noise ratio เพิ่มขึ้น

ผู้ที่สนใจที่จะวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหัวอ่าน-เขียนหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้จากโครงสร้างการทำงานของแต่ละเทคโนโลยีของการผลิต หากองค์ความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะให้ผู้วิจัยสามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ปัญหานี้จะส่งผลต่อการวิจัยโดยตรงซึ่งจะทำให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปได้ก่อนข้างลำบาก

## បររលាយករណ

- [1] Hitachi global storage technologies. Thermal Fly-height Control (TFC) Technology in Hitachi Hard Disk Drives, [Online] November 19 2008.  
[http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/98EE13311A54CAC886257171005E0F16/\\$file/TFC\\_whitepaper041\\_807.pdf](http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/98EE13311A54CAC886257171005E0F16/$file/TFC_whitepaper041_807.pdf)
- [2] Y. Zhi-Min, W. Lei, Z. Wei, H. Sheng-Bin, X. Rui, N. Ka Wei, and L. Bo. In-Situ Flying Height Testing Technology. Asia-Pacific Magnetic Recording Conference., pp.TU-P-13-01 - TU-P-13-02, 2002.
- [3] B. Liu, S.K. Yu, W.D. Zhou, C. H. Wong, and W. Hua. Low Flying-Height Slider with High Thermal Actuation Efficiency and Small Flying-Height Modulation Caused by Disk Waviness. IEEE Magnetics Transactions., Vol. 44, pp.145-150, 2008.
- [4] H. Li, B. Liu and T. C. Chong. Interface solution for writing-induced nano-deformation of slider body. Journal of Magnetism and Magnetic Materials., Vol. 303, pp. e86–e90, 2006.
- [5] F. Chen, H. Xie and G.K. Fedder. A MEMS-based monolithic electrostatic microactuator for ultra-lowmagnetic disk head fly height control. IEEE Magnetics Transactions., Vol. 37, pp.1915 – 1918, 2001.
- [6] Jeffrey Lille, S., and Mike Suk. (2008). Predictive Failure Analysis of Thermal Flying Height Control System and Method, US. Patent No. 7336434
- [7] Yiping Ma. (2008). Detection of Fly Height Change in a Disk Drive, US. Patent No. 2008/0013198A1
- [8] Hitachi global storage techonologies. The era of giant magnetoresistive heads, [Online] April 12 2009, <http://www.hitachigst.com/hdd/technolo/gmr.htm>
- [9] L.K. Mustakallio. Hard Disk Basics, [Online] April 12 2009,  
<http://keppanet.netfirms.com/keppanet/harddisk.htm>
- [10] Abdullah Al Mamun, GuoXiao Guo, Chao Bi . Hard Disk Drive Mechatronics and Control. USA: Taylor & Francis Group, 2006.
- [11] Hitachi global storage technologies. Drive Fitness Test, [Online] November 19 2008.  
<http://www.hitachigst.com/hdd/technolo/dft/dft.htm>

- [12] Hitachi Global Storage Technologies Japan, Ltd. (2006). Disk storage device. US. Patent No. 6989957.
- [13] Charles M. Kozierok. Giant Magnetoresistive (GMR) Heads, [Online] April 12 2009.  
<http://www.pcguide.com/ref/hdd/op/heads/techGMR-c.html>
- [14] Toshiba. Comparison of Recording Systems in HDD, [Online] April 12 2009.  
[http://www.toshiba.co.jp/about/press/2004\\_12/pr1401.htm](http://www.toshiba.co.jp/about/press/2004_12/pr1401.htm)
- [15] Guzik Technical Enterprises. Introduction to Perpendicular Recording, [Online] April 12 2009. [http://www.guzik.com/solutions\\_chapter7.shtml](http://www.guzik.com/solutions_chapter7.shtml)
- [16] Hitachi global storage technologies. Recording Head/CPP Tunnel Valve, [Online] April 12 2009. [http://www.hitachigst.com/hdd/research/recording\\_head/cpp/index.html](http://www.hitachigst.com/hdd/research/recording_head/cpp/index.html)
- [17] Data Recovery Centre. How Does A Hard Drive Work, [Online] May 12 2010,  
[http://www.datarecoverycentre.co.uk/how\\_hard\\_disks\\_work.htm](http://www.datarecoverycentre.co.uk/how_hard_disks_work.htm)
- [18] Quickpc. การเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HardDiskDrive) , [Online] December 10 2008.  
[http://www.Quickpc.co.th/quick\\_data/guide/Hdd/hdd.htm](http://www.Quickpc.co.th/quick_data/guide/Hdd/hdd.htm)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก โปรแกรมภาษา Matlab สำหรับทดสอบอัลกอริทึม

```
function [FH,FH_str]=FH_WindowsPeakDetect(dataInput,set_sample,windows,graph)
TDP=dataInput;

% Test only
% set_sample=700;

% windows=15
% Calculate variable to convert to true FH
TDPsize=size(TDP);
TDPColumnSize=TDPsize(2);

% Convert data 2D array to 1D
TDP1D=Array2Dto1D(TDP);

% Testing somethings
dat=TDP;
datSort=sort(dat,2);
% end testing something

% Manage data to 2D arrary by scroll window
numData=size(TDP1D);
windows>windows;

windowsMax>windows;
windowsMin=1;
windowsMid=int16(windows/2);
count=0;
for i=1:(numData(2)-windows)
    for j=0:windows-1
        TDP2D(i,j+1)=TDP1D(i+j);
```

```

    end
end

numData=size(TDP2D);
dataSize=numData(1); %is 10000x15 <-> (1)x(2) numData(1) is 1000

data=TDP2D;
% Show data array
data_size=size(data);
% data_size(1)=row,2=column
% Ans 115 15
% Row=115 Colum=15
row=data_size(1);
column=data_size(2);
%data(row,column)

%data=[ 546378912
%      546378912
%      546378912]
% Arrange data value from minimum to maximum at each row
data_AfterSort=sort(data,2);

data_absAfterSort=abs(data_AfterSort);
% (data,1) column, (data,2) row
%After sort row
%[ 123456789
% 123456789
% 123456789]

dummy_data=data_absAfterSort;

```

```

if (set_sample<=0)
    set_sample=700;
else
    set_sample=set_sample;
end

% Fill data to calculate average line

for count=1:set_sample
    data_fill(count,windowsMin)=dummy_data(count,windowsMin);
    data_fill(count,windowsMid)=dummy_data(count,windowsMid);
    data_fill(count,windowsMax)=dummy_data(count,windowsMax);
end

% Arrange value to find Max Min

data_fillSort=sort(data_fill,1);

% Find average column 1, 7, 15

column_1=0;
column_7=0;
column_15=0;
for count=1:set_sample
    column_1=column_1+data_fillSort(count,windowsMin);
    column_7=column_7++data_fillSort(count,windowsMid);
    column_15=column_15++data_fillSort(count,windowsMax);
end

% Arrange value

Avg(windowsMin)=column_1/set_sample;
Avg(windowsMid)=column_7/set_sample;
Avg(windowsMax)=column_15/set_sample;
if (graph>0)
str = ['Avg Min Mid Max:',num2str(Avg(windowsMin)), ...

```

```

num2str(Avg(windowsMid)),num2str(Avg(windowsMax))];

disp(str);

end

% Base line = average+peak

B(windowsMin)=Avg(windowsMin)+data_fillSort(set_sample,windowsMin);
B(windowsMid)=Avg(windowsMid)+data_fillSort(set_sample,windowsMid);
B(windowsMax)=Avg(windowsMax)+data_fillSort(set_sample,windowsMax);

factor=1.4;

% Detect data exceed above of Base line

% colum 1 (Minimum)

columnDetect=windowsMin;

% B(columnDetect)=data_fillSort(set_sample,columnDetect)*factor;

% data_fillSort(set_sample,columnDetect) -> Peak of sample

B(columnDetect)= data_fillSort(set_sample,columnDetect) ...
+ ((data_fillSort(set_sample,columnDetect) ...
- Avg(columnDetect))*1);

count=0;
for i=1:(dataSize-windows)
    count=count+1;
    if (data_absAfterSort(i,columnDetect)>B(columnDetect))
        if (graph>0)
            str = ['found Min Data exceed: ',num2str(count/TDPColumnSize), ...
            ' count: ',num2str(count)];
            disp(str);
            %     disp(count);
        end
        break;
    end

```

```

end

% Store output
FH=count/TDPColumnSize;
FH_str='found Min Data exceed: ';

% Detect data exceed above of Base line
% colum 7 (Mid)
columnDetect=windowsMid;
% B(columnDetect)=data_fillSort(set_sample,columnDetect)*factor;
B(columnDetect)= data_fillSort(set_sample,columnDetect) ...
+ ((data_fillSort(set_sample,columnDetect) ...
- Avg(columnDetect))*1);

count=0;
for i=1:(dataSize-windows)
    count=count+1;
    if (data_absAfterSort(i,columnDetect)>B(columnDetect))
        if (graph>0)
            str = ['found Mid Data exceed: ',num2str(count/TDPColumnSize), ...
            ' count: ',num2str(count)];
            disp(str);
        %     disp(count);
    end
    break;
end
% Store output
if (FH>count/TDPColumnSize)
    FH=count/TDPColumnSize;
    FH_str='found Mid Data exceed: ';

```

```

end

% Detect data exceed above of Base line

% colum 15 (Mid)

columnDetect=windowsMax;

% B(columnDetect)=data_fillSort(set_sample,columnDetect)*factor;

B(columnDetect)= data_fillSort(set_sample,columnDetect) ...
    + ((data_fillSort(set_sample,columnDetect) ...
    - Avg(columnDetect))*1);

count=0;

for i=1:(dataSize-windows)

    count=count+1;

    if (data_absAfterSort(i,columnDetect)>B(columnDetect))

        if (graph>0)

            str = ['found Max Data exceed: ',num2str(count/TDPColumnSize), ...
                ' count: ',num2str(count)];

            disp(str);

        end

        break;

    end

end

% Store output

if (FH>count/TDPColumnSize)

    FH=count/TDPColumnSize;

    FH_str='found Max Data exceed: ';

end

FH;
FH_str;

```

```

if(graph>0)

% Plot graph raw data

figure;

columnPlot=windowsMin;

subplot(4,1,2); % SUBPLOT(m,n,p)->m-by-n matrix of small axes

% plot(data_absAfterSort(1:dataSize,columnPlot)); % plot(X,Y)

% plot(1:dataSize,B(1));

plot(1:dataSize,B(columnPlot), ...

1:dataSize,data_absAfterSort(1:dataSize,columnPlot), ...

1:dataSize,Avg(windowsMin));

title('Min data detect');

columnPlot=windowsMid;

subplot(4,1,3); % SUBPLOT(m,n,p)->m-by-n matrix of small axes

% plot(data_absAfterSort(1:dataSize,columnPlot)); % plot(X,Y)

% plot(1:dataSize,B(1));

plot(1:dataSize,B(columnPlot), ...

1:dataSize,data_absAfterSort(1:dataSize,columnPlot), ...

1:dataSize,Avg(windowsMid));

title('Mid data detect');

columnPlot=windowsMax;

subplot(4,1,4); % SUBPLOT(m,n,p)->m-by-n matrix of small axes

% plot(data_absAfterSort(1:dataSize,columnPlot)); % plot(X,Y)

% plot(1:dataSize,B(1));

plot(1:dataSize,B(columnPlot), ...

1:dataSize,data_absAfterSort(1:dataSize,columnPlot), ...

1:dataSize,Avg(windowsMax));

title('Max data detect');

```

```
subplot(4,1,1); % SUBPLOT(m,n,p)->m-by-n matrix of small axes
plot(TDP1D);
str = ['Raw data average Min',num2str(Avg(windowsMin)), ...
'] Mid[',num2str(Avg(windowsMid)),'] Max [',num2str(Avg(windowsMax)),'];
title(str);
end
```

## ประวัติผู้เขียน

|                      |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| ชื่อ สกุล            | นายธัญญพร ชาญณรงค์       |                     |
| รหัสประจำตัวนักศึกษา | 5010120136               |                     |
| <b>วุฒิการศึกษา</b>  |                          |                     |
| วุฒิ                 | ชื่อสถาบัน               | ปีที่สำเร็จการศึกษา |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 2549                |
| (วิศวกรรมไฟฟ้า)      |                          |                     |

### **ทุนการศึกษา (ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา)**

ทุนวิจัย ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไคร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

### **การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน**

Tanyaporn Channarom, Nattha Jindapetch, and Krerkchai Thongnoo, “Study of the Variance of the Hard Disk Drive Read/Write Head Touch Down Power for Setting Fly-Height”, The 8<sup>th</sup> PSU Engineering Conference PEC (8), April 22-23, 2010.